

陕西亚成微电子股份有限公司



REACTOR
Microelectronics
亚成微电子

公开转让说明书

主办券商

CMS  招商证券

二零一三年十月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、控股股东不当控制风险

公司控股股东余远强持有公司 700.56 万股的股份，占公司股份总数的 58.38%。余远强任公司董事长兼总经理，对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均具有实际的控制权，若其不当利用该种控制权，则可能损害公司和其他股东的利益。

二、公司治理的风险

股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

三、核心技术人员流失或短缺的风险

公司作为 IC 设计企业，核心竞争力主要体现在自主研发能力和稳定的研发团队上。公司的发展在很大程度上取决于产品的研发速度，因此公司对高端技术人才有较大需求。国内对集成电路设计人员需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并保留人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。

四、委托加工风险

国内 IC 设计企业大部分采取委托加工的经营模式，即仅从事 IC 产品的设计、销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。无生产线经营模式具有轻便灵活的特点，公司选择此模式没有沉重的生产线运营负担，也无需负担芯片生产线昂贵的维护成本，可以专注于技术创新；通过开发业界领先的技术，依靠晶圆代工厂将技术转化为芯片产品，可以专注于自己的核心业务，充分发挥核

心竞争力。但随之而来的风险是晶圆代工、封装、测试等环节需要依赖供应商的工艺平台，在产能、交货期限以及不可抗力因素方面，公司存在一定程度的委托加工风险。

目 录

释 义	3
第一章 公司基本情况	5
一、公司概况	5
二、股票挂牌情况	6
三、公司股权结构	7
四、公司成立以来股本的形成及其变化情况	10
五、公司重大资产重组情况	20
六、控股、参股子公司情况	20
七、公司董事、监事、高级管理人员情况	20
八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标	23
九、与本次挂牌有关的机构	24
第二章 公司业务	26
一、公司主营业务及主要产品	26
二、公司组织结构及主要生产流程	32
三、公司业务相关的关键资源要素	36
四、公司业务经营情况	48
五、公司商业模式	56
六、公司所处行业的基本情况	57
第三章 公司治理	70
一、公司最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	70
二、公司董事会关于公司治理机制的说明	70
三、公司最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况	71
四、公司独立运营情况	71
五、公司同业竞争情况	71

六、公司近两年一期内资金被控股股东、实际控制人占用情况	72
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况	72
八、公司为了防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排	74
九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况	75
十、公司董事、监事、高级管理人员近两年一期内的变动情况和原因	77
第四章 公司财务	79
一、最近两年一期财务报表和审计意见	79
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	86
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	103
四、关联交易	120
六、资产评估情况	121
七、股利分配	121
八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况	122
九、影响公司持续经营的风险因素	122
第五章 有关声明	125
第六章 附件	135

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、亚成微电子	指	陕西亚成微电子股份有限公司
有限公司	指	陕西亚成微电子有限责任公司及其前身陕西寰宇企业管理咨询有限公司
陕西寰宇	指	陕西寰宇企业管理咨询有限公司
股东会	指	陕西亚成微电子有限责任公司股东会或其前身陕西寰宇企业管理咨询有限公司股东会
股东大会	指	陕西亚成微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	陕西亚成微电子股份有限公司董事会
监事会	指	陕西亚成微电子股份有限公司监事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
本说明书	指	陕西亚成微电子股份有限公司公开转让说明书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《陕西亚成微电子股份有限公司章程》
希格玛、会计师事务所	指	希格玛会计师事务所有限公司
金诚同达、律师事务所	指	北京金诚同达律师事务所西安分所
集成电路	指	Integrated Circuit，简称“IC”，将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的IC产品。
布图	指	确定用以制造集成电路的电子元件在一个传导材料中的几何图形排列和连接的布局设计。
封装	指	把硅片上的电路管脚用导线接到外部接头处，以便于其他器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
Fabless	指	无生产线的IC设计公司。
CMOS	指	Complementary metal oxide semiconductor的缩写，一种将PMOS（Positive channel Metal Oxide Semiconductor）

		管和NMOS（N-Mental Oxide Semiconductor）管在同一个硅衬底上混合制造的工艺。
BICMOS	指	Bipolar CMOS，该电路既具有CMOS电路高集成度、低功耗特点，又获得了双极电路强电流驱动能力的优势。
PWM	指	Pusle Width Modulation的缩写，脉宽调制。
PFM	指	Pusle Frequency Modulation的缩写，脉冲频率调制。
VCC	指	IC电源引入端
NTC	指	Negative Temperature Coefficient的缩写，热敏电阻。
EMI	指	Electro Magnetic Interference的缩写，电磁干扰。
PFC	指	Power Factor Correction的缩写，功率因数校正。
ESD	指	Electro Static Discharge的缩写，芯片管脚静电保护。
SoC	指	System on Chip的缩写，称为芯片级系统，意指它是一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。

第一章 公司基本情况

一、公司概况

公司中文名称：陕西亚成微电子股份有限公司

公司英文名称：Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd

注册资本：1,200万元

实收资本：1,200万元

法定代表人：余远强

有限公司成立日期：2003年9月19日

股份公司成立日期：2011年6月30日

住所：西安市高新区高新三路9号信息港大厦105室

企业法人营业执照注册号：610000100084611

组织机构代码：75214690-X

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）—计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为制造业（C）—通信设备、计算机及其他电子设备制造业（C39）—集成电路制造（C3963）。

主营业务：数字模拟混合集成电路产品的设计、开发和销售

董事会秘书兼信息披露负责人：陈彬

邮编：710065

电话：（029）82300562

传真：（029）82300507

电子信箱：cb@reactor-micro.com

互联网网址：<http://www.reactor-micro.com/>

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：430552

股份简称：亚成微

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：1,200 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十二条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条和《公司章程》第二十六条的规定，股东所持公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让的数量如下：

序号	名称或姓名	在公司任职	持股数 (万股)	持股比例 (%)	是否存在 质押 或冻结 情况	本次可公开转 让的数量(万 股)
1	余远强	董事长、总经理	700.56	58.38	否	175.14
2	张炜东	董事	102.60	8.55	否	25.65
3	胡晓博	董事、副总经理	90.00	7.50	否	22.50
4	刘欣		51.36	4.28	否	51.36
5	詹波		51.36	4.28	否	51.36
6	李葆春		36.00	3.00	否	36.00
7	杨波	董事	30.00	2.50	否	7.50
8	赵军亚		18.00	1.50	否	18.00
9	李大鹏		18.00	1.50	否	18.00

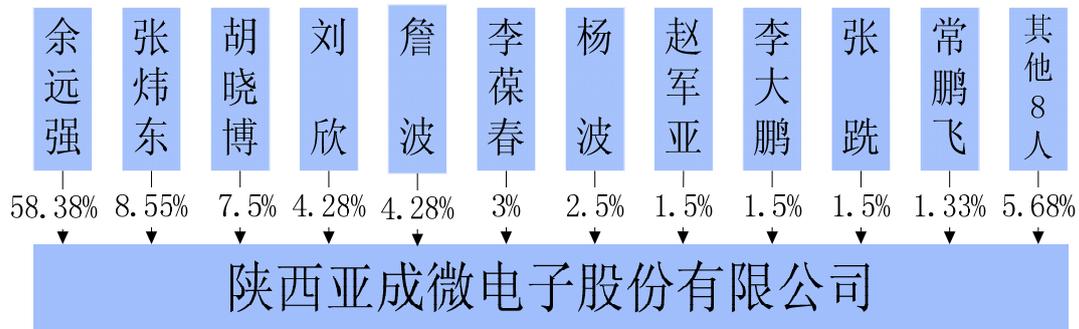
序号	名称或姓名	在公司任职	持股数 (万股)	持股比例 (%)	是否存在 质押 或冻结 情况	本次可公开转 让的数量(万 股)
10	张 跣		18.00	1.50	否	18.00
11	常鹏飞		15.96	1.33	否	15.96
12	项行萍		9.96	0.83	否	9.96
13	陈 彬	董事会秘书、财务 负责人	9.96	0.83	否	2.49
14	冯晓波	监事	8.04	0.67	否	2.01
15	杨世红	董事	8.04	0.67	否	2.01
16	毛有军		8.04	0.67	否	8.04
17	陈楷华	监事会主席	8.04	0.67	否	2.01
18	杜善周		8.04	0.67	否	8.04
19	赵建豪		8.04	0.67	否	8.04
合计			1200.00	100.00		482.07

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

除上述股份锁定限制外，公司股东对其所持有股份未作出其他自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构

(一) 股权结构图



(二) 主要股东情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

自有限公司成立始，余远强先生即为公司第一大股东，并在历次股权变动中持股比例均超 50%，且一直担任有限公司、股份公司的执行董事或董事长，对本公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响，为本公司的控股股东、实际控制人。

余远强：男，1970 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年毕业于西安交通大学半导体专业，获学士学位。1992 年至 1998 年在咸阳偏转集团公司工作，历任研发部研发工程师、集团子公司威海大宇电子项目部长、CIMS 系统开发组长、集团公司副总经理；1999 年至 2006 年任上海环信投资咨询公司执行董事、投资分析工程师；2003 年至 2007 年 3 月任有限公司执行董事；2007 年 4 月至今任有限公司和股份公司董事长兼总经理。

2、控股股东、实际控制人最近两年一期内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近两年一期内未发生变化。

3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况

(1) 公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东持股数量、持股比例

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	余远强	700.56	58.38
2	张炜东	102.60	8.55
3	胡晓博	90.00	7.50
4	刘欣	51.36	4.28
5	詹波	51.36	4.28
6	李葆春	36.00	3.00
7	杨波	30.00	2.50
8	赵军亚	18.00	1.50
9	李大鹏	18.00	1.50
10	张跣	18.00	1.50
合计		1,115.88	92.99

(2) 前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况

余远强：详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

张炜东：男，1975 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。1995 年毕业于上海财经大学国际商务专业，2005 年毕业于上海海事大学工商管理专业。1995 年至 2011 年分别在亨利货运（香港）有限公司上海办事处、上海阳帆国际货运代理有限公司任职，现任上海阳帆国际货运代理有限公司总经理。

胡晓博：男，1969 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年毕业于陕西工学院无线电技术专业，获学士学位。1992 年 7 月至 2008 年 2 月分别任台湾敦吉股份公司日立半导体销售代表、美国 ISSI 公司深圳办事处经理、香港汇贤电子公司三星液晶屏销售经理、深圳沛粤电子公司销售总监，2008 年 3 月加入有限公司，并自加入至今任本公司副总经理。

刘欣：女，1975 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年毕业于上海交通大学，获硕士学位。1995 年至 1998 年就职于韩国大宇电子海外部，1999 至 2000 年就职于威海高新大宇电子海外部，2001 年至 2002 年就职于优派显示设备上海公司，2003 至今就职于欧菲滤清器有限公司，任供应链经理。

詹波：男，1982 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年毕业于中国人民解放军西安通讯学院，主修计算机技术。2006 年至 2008 年任 SAP 中国杭州分公司 ERP 项目主管，2009 年加入有限公司，并自加入至今任本公司销售经理。

李葆春：男，1972 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1993 年毕业于西安交通大学工业电气自动化专业。1993 年至 1998 年在艾默生有限公司西安办事处工作，1999 年至今在陕西兴伟科技发展有限公司工作并担任总经理。

杨波：男，1976 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002

年7月毕业于西安科技大学。毕业后至今在西安科技大学电控学院从事教学科研工作。2001年至2007年间在西安中芯微电子技术公司、陕西美欧电信微电子技术有限公司、北京时代民芯微电子技术有限公司从事集成电路研发工作。2008年至今任本公司IC设计总监，擅长LDO/DCDC/ACDC集成电路产品的开发、通晓IPOLAR/CMOS/BICMOS/BCD/VDMOS工艺设计平台，完成多款数模混合集成电路芯片设计。

赵军亚：男，1968年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1992年7月毕业于西安交通大学电子工程系，毕业后一直在西安交通大学从事教学科研工作，科研方向主要为开关电源和自动化控制系统设计。1995年加入中国电源学会，1996年至1999年在该校自控系完成硕士研究生课程学习，1999年起担任中国电源学会理事。2008年7月至今任公司系统设计部产品经理，为本公司产品设计过多种开关电源，并为Fairchild、Infineon、ST等公司的电源控制IC设计过100多种应用方案。

李大鹏：男，1971年6月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年毕业于西北税务学校，1993年至1995年在中央党校经济管理本科班进修，目前在北京大学PE和资本运营董事长研修班进修。1990年至2013年间分别在陕西省农电管理局、陕西秦电公司、西安一方防伪科技公司、陕西太华建设装饰有限公司、陕西太华置业有限公司、陕西远大科工贸有限公司、陕西中太能源投资有限公司、陕西鲲鹏实业有限公司等任职，现任陕西鲲鹏实业有限公司董事长、总经理。

张跣：1970年4月生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1993年毕业于西北大学，2003年毕业于北京师范大学。1996年到2013年分别在中国作家协会、北京外企服务集团、中国青年政治学院任职，现为中国青年政治学院教师。

4、其他争议事项的具体情况及其关联关系

本公司无其他争议事项。公司股东均为自然人，相互之间没有亲属关系，不存在关联关系。

四、公司成立以来股本的形成及其变化情况

（一）有限公司的设立

公司前身为陕西寰宇企业管理咨询有限公司，由自然人余远强、张文英于2003年9月共同出资100万元组建设立。

2003年9月17日，西安康达有限责任会计师事务所出具西康验字【2003】第1208号《验资报告》，该报告审验确认：截至2003年9月17日止，陕西寰宇（筹）已收到出资各方以货币缴纳的注册资本100万元，其中：股东余远强于2003年9月16日将其出资80万元、股东张文英于2003年9月16日将其出资20万元缴存陕西寰宇临时账户西安市碑林区长安路农村信用合作社文艺南路分社0402015-2011117-08账号内。

2003年9月19日，陕西省工商行政管理局核准了本次设立登记，核发注册号为6100002051062的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，陕西寰宇住所：西安市高新开发区枫叶大厦A座；法定代表人：余远强；注册资本：100万元整；经营范围：商业市场调研及分析；国际经贸咨询；科技产业和环保信息咨询；投资咨询及商业信息咨询服务（以上经营范围，涉及专项规定的，凭许可证经营）。

有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	80.00	80.00	货币
张文英	20.00	20.00	货币
合计	100.00	100.00	

（二）有限公司的第一次股权转让

2004年2月2日，陕西寰宇召开第二次股东会，同意张文英将其持有的陕西寰宇20%股权以20万元转让给新股东王飞。2004年2月3日，出让方张文英与受让方王飞签订《股权转让协议》，将其持有的陕西寰宇20%股权转让给王飞。

2004年2月14日，陕西寰宇就本次股权转让向陕西省工商行政管理局进

行变更登记。

第一次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	80.00	80.00	货币
王 飞	20.00	20.00	货币
合 计	100.00	100.00	—

（三）有限公司的第二次股权转让及第一次名称、住所和经营范围变更

2006年10月8日，陕西寰宇召开第三次股东会同意：王飞将持有陕西寰宇全部20%的股权以20万元转让给朱樟明，余远强将持有陕西寰宇5%的股权以5万元转让给朱樟明。同日，王飞、余远强各自签署《股权转让确认书》对本次股权转让事宜进行确认。

2006年10月8日，陕西寰宇原股东余远强与新股东朱樟明召开股东会，一致同意：将陕西寰宇名称变更为“陕西亚成微电子有限责任公司”；将有限公司地址迁移至“西安市高新区唐延路旺座现代城C座”；将有限公司经营范围调整为“集成电路设计及其系统产品的生产销售；电子产品的开发与销售；计算机软件的开发；销售本公司的自产产品；代理其他公司的集成电路产品”。

2006年10月13日，陕西省工商行政管理局核准了上述其他变更登记，但将经营范围限定为“集成电路设计及系统产品的生产、销售；电子产品的开发与销售；计算机软件的开发”。

第二次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	75.00	75.00	货币
朱樟明	25.00	25.00	货币
合 计	100.00	100.00	—

（四）有限公司的第二次住所变更

2007年3月5日，有限公司召开第四次股东会，股东一致同意将有限公

司住所迁至“西安市高新三路9号信息港大厦302室”。

2007年3月21日，陕西省工商行政管理局核准了本次变更登记。

(五) 有限公司的第一次增加注册资本

2008年3月10日，有限公司召开股东会，股东余远强、朱樟明一致同意：新增注册资本13.64万元，将有限公司注册资本增加至113.64万元；增加张炜东、吴丽萍、刘欣三人为新股东：张炜东认缴100万元，其中6.82万元增加注册资本，93.18万元转作资本公积；吴丽萍认缴50万元，其中3.41万元增加注册资本，46.59万元转作资本公积；刘欣认缴50万元，其中3.41万元增加注册资本，46.59万元转作资本公积。

2008年3月13日，陕西元通会计师事务所有限责任公司就本次增资出具陕元通验字（增）【2008】03023号《验资报告》确认：截至2008年3月13日止，有限公司已分别收到张炜东、吴丽萍、刘欣实际缴纳的出资100万元、50万元和50万元，均为货币出资，且已于2008年3月13日缴存有限公司在中国银行西安科技路支行开立的人民币账户308649054568099001账号内；张炜东所缴出资中的6.82万元，吴丽萍所缴出资中的3.41万元，刘欣所缴出资中3.14万元进入注册资本，其余186.36万元列入资本公积。

2008年4月8日，陕西省工商行政管理局核准了上述注册资本增加变更登记，换发了新的营业执照，新注册号610000100084611。

第一次增加注册资本后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	75.00	66.00	货币
朱樟明	25.00	22.00	货币
张炜东	6.82	6.00	货币
吴丽萍	3.41	3.00	货币
刘欣	3.41	3.00	货币
合计	113.64	100.00	—

(六) 有限公司的第三次股权转让和第三次住所变更

2008年10月21日，有限公司召开第四次股东会，股东余远强、朱樟明、张炜东、吴丽萍、刘欣一致同意原股东朱樟明将其持有的有限公司22%股权以25万元转让给新股东李葆春；同日，出让方朱樟明与受让方李葆春签订《股权转让协议书》，同时，有限公司承诺此次股权转让的申请材料、证明文件真实、有效、合法。

2008年10月21日，有限公司召开第五次股东会，全体股东余远强、李葆春、张炜东、吴丽萍、刘欣同意将公司住所迁至“西安市高新三路9号信息港大厦3A02室”。

2008年10月28日，陕西省工商行政管理局核准了上述变更登记。

第三次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	75.00	66.00	货币
李葆春	25.00	22.00	货币
张炜东	6.82	6.00	货币
吴丽萍	3.41	3.00	货币
刘欣	3.41	3.00	货币
合计	113.64	100.00	—

（七）有限公司的第二次增资

2009年1月2日，有限公司召开第六次股东会，全体股东一致同意：将注册资本增加至333.64万元；新增220万元由原股东按原出资比例进行增资，即余远强认缴145.20万元，李葆春认缴48.40万，张炜东认缴13.20万元，吴丽萍认缴6.60万元，刘欣认缴6.60万元出资；各股东以货币方式认缴出资。

2009年1月7日，西安航达会计师事务所有限责任公司就本次增资情况出具西航会验字（2009）002号《验资报告》，该报告审验确认：截至2009年1月6日止，有限公司已分别收到股东余远强缴纳的新增资本金145.20万元、李葆春缴纳的新增资本金48.40万元、张炜东缴纳的新增资本金13.20万元、吴丽萍缴纳的新增资本金6.60万元、刘欣缴纳的新增资本金6.60万元，合计220万

元于 2009 年 1 月 6 日缴存中信银行西安科技路支行有限公司账户（账号：7252410182600010130）。

2009 年 1 月 9 日，陕西省工商行政管理局核准了本次注册资本增加变更登记。

第二次增资后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	220.20	66.00	货币
李葆春	73.40	22.00	货币
张炜东	20.02	6.00	货币
吴丽萍	10.01	3.00	货币
刘欣	10.01	3.00	货币
合计	333.64	100.00	—

（八）有限公司的第四次股权转让

2009 年 2 月 15 日，有限公司召开第七次股东会，全体股东一致同意：李葆春将其持有的有限公司 22% 股权（出资额 73.40 万元）中的 17% 计 56.72 万元转让给新股东陈丹；余远强将其持有的有限公司 66% 股权（出资额 220.20 万元）中的 5% 计 16.68 万元转让给新股东陈丹。2009 年 2 月 20 日，出让方李葆春、余远强分别与受让方陈丹签订《股权转让协议书》，对本次股权转让事宜进行了确认。

2009 年 3 月 5 日，就上述股权转让情况，有限公司向陕西省工商行政管理局进行了变更登记。

经第四次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	203.52	61.00	货币
陈丹	73.40	22.00	货币
张炜东	20.02	6.00	货币

李葆春	16.68	5.00	货币
吴丽萍	10.01	3.00	货币
刘欣	10.01	3.00	货币
合计	333.64	100.00	—

(九) 有限公司第五次股权转让

2011年4月8日，有限公司召开临时股东会，全体股东余远强、陈丹、张炜东、李葆春、吴丽萍、刘欣一致同意按照下表所列转让方、受让方、转让比例和转让金额对有限公司的股权进行转让：

转让方	转让额（万元）	转让比例（%）	转让价格（万元）	受让方
陈丹	73.40	22.00	73.40	余远强
余远强	5.86	1.76	5.86	刘欣
余远强	11.68	3.50	11.68	张炜东
余远强	27.80	8.33	27.80	胡晓博
余远强	9.27	2.78	9.27	杨波
余远强	5.86	1.76	5.86	詹波
吴丽萍	10.01	3.00	10.01	詹波
李葆春	5.56	1.67	5.56	赵军亚

2011年4月18日，上述转让方和受让方分别签订《股权转让协议》：转让方同意将其持有的部分股权以等价转让给受让方，受让方同意按此价格购买上述股权；受让方同意在本协议订立后3日内，以现金形式将转让款支付给出让方；转让方保证其所转让股权是合法拥有且具有完全的处分权。

2011年4月28日，有限公司就本次股权转让情况向陕西省工商行政管理局进行了变更登记。

经第五次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	216.43	64.87	货币

张炜东	31.70	9.50	货币
胡晓博	27.80	8.33	货币
詹波	15.88	4.76	货币
刘欣	15.88	4.76	货币
李葆春	11.12	3.33	货币
杨波	9.27	2.78	货币
赵军亚	5.56	1.67	货币
合计	333.64	100.00	—

(十) 有限公司第三次增资

2011年4月11日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意：将注册资本由原333.64万元增加至370.71万元；新增37.07万元由新股东李大鹏、张跣、常鹏飞、项行萍、陈彬、冯晓波、杨世红、毛有军、陈楷华、杜善周、赵建豪以货币方式认缴，新股东应各自认缴的出资额如下：

股 东	出资额（万元）	认缴出资（万元）	转入资本公积（万元）
李大鹏	90.00	5.56	84.44
张 跣	90.00	5.56	84.44
常鹏飞	80.00	4.95	75.05
项行萍	50.00	3.09	46.91
陈 彬	50.00	3.09	46.91
冯晓波	40.00	2.47	37.53
杨世红	40.00	2.47	37.53
毛有军	40.00	2.47	37.53
陈楷华	40.00	2.47	37.53
杜善周	40.00	2.47	37.53
赵建豪	40.00	2.47	37.53
合计	600.00	37.07	562.93

2011年4月19日，希格玛会计师事务所有限公司出具希会验字（2011）

验 037 号《验资报告》，该报告审验确认：截至 2011 年 4 月 19 日止，有限公司已收到新股东缴纳的货币出资 600 万元，其中实收资本额合计 37.07 万元，资本公积额合计 562.93 万元，上述出资已于 2011 年 4 月 14 日缴存有限公司在中国银行西安科技路支行开立的人民币账户 103217742629 账号内。

2011 年 4 月 28 日，陕西省工商行政管理局核准了本次增资。

第三次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
余远强	216.43	58.38	货币
张炜东	31.70	8.55	货币
胡晓博	27.80	7.50	货币
刘 欣	15.88	4.28	货币
詹 波	15.88	4.28	货币
李葆春	11.12	3.00	货币
杨 波	9.27	2.50	货币
赵军亚	5.56	1.50	货币
李大鹏	5.56	1.50	货币
张 跣	5.56	1.50	货币
常鹏飞	4.95	1.33	货币
项行萍	3.09	0.83	货币
陈 彬	3.09	0.83	货币
冯晓波	2.47	0.67	货币
杨世红	2.47	0.67	货币
毛有军	2.47	0.67	货币
陈楷华	2.47	0.67	货币
杜善周	2.47	0.67	货币
赵建豪	2.47	0.67	货币
总计	370.71	100.00	—

（十一）有限公司整体变更为股份公司

2011年6月2日，有限公司召开2011年第六次临时股东会，经19名自然人股东一致同意，形成如下决议：

1、同意将有限公司整体变更为股份公司，股份公司名称已预先核准为陕西亚成微电子股份有限公司。

2、同意希格玛会计师事务所有限公司出具的基准日为2011年4月30日的希会审字（2011）0952号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2011年4月30日，有限公司总资产为19,198,038.02元，总负债为7,160,831.94元，净资产为12,037,206.08元。

3、同意西安正衡资产评估有限责任公司出具的评估基准日为2011年4月30日的西正衡评报字【2011】067号《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》，截止2011年4月30日，有限公司的总资产为2,093.16万元，总负债为716.08万元，净资产为人民币1,377.08万元。

4、同意将有限公司经审计后的净资产1200万元作为股份公司的注册资本按1:1的比例折合为股份公司成立后的股本总额1200万股（每股面值人民币1.00元），有限公司现股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份；净资产超过注册资本的部分列入股份公司的资本公积金。

2011年6月20日，19名自然人股东召开股份公司创立大会，会议审议通过《股份公司筹建工作报告》、《关于股份公司设立费用的报告》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件，决定成立陕西亚成微电子股份有限公司。

2011年6月3日，希格玛会计师事务所有限公司出具希会验字（2011）062号《验资报告》确认：截至2011年6月3日，股份公司（筹）已收到全体股东以净资产折合的注册资本（股本）总额合计1200万元。

2011年6月30日，陕西省工商行政管理局核准了上述变更登记。

有限公司整体变更为股份公司后，各发起人（股东）持有公司的股份情况

如下：

股 东	股份（万股）	比例（%）	出资方式
余远强	700.56	58.38	净资产折股
张炜东	102.60	8.55	净资产折股
胡晓博	90.00	7.50	净资产折股
刘 欣	51.36	4.28	净资产折股
詹 波	51.36	4.28	净资产折股
李葆春	36.00	3.00	净资产折股
杨 波	30.00	2.50	净资产折股
赵军亚	18.00	1.50	净资产折股
李大鹏	18.00	1.50	净资产折股
张 跣	18.00	1.50	净资产折股
常鹏飞	15.96	1.33	净资产折股
项行萍	9.96	0.83	净资产折股
陈 彬	9.96	0.83	净资产折股
冯晓波	8.04	0.67	净资产折股
杨世红	8.04	0.67	净资产折股
毛有军	8.04	0.67	净资产折股
陈楷华	8.04	0.67	净资产折股
杜善周	8.04	0.67	净资产折股
赵建豪	8.04	0.67	净资产折股
合 计	1200.00	100.00	

五、公司重大资产重组情况

截至本说明书签署日，公司无重大资产重组情况。

六、控股、参股子公司情况

截至本说明书签署日，公司无控股、参股子公司。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事基本情况

公司本届董事会由五名董事构成, 全体董事均由本公司股东大会选举产生。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	余远强	男	43	董事长	2011/6/20----2014/6/19
2	张炜东	男	38	董事	2011/6/20----2014/6/19
3	胡晓博	男	44	董事	2011/6/20----2014/6/19
4	杨波	男	37	董事	2011/6/20----2014/6/19
5	杨世红	男	43	董事	2013/5/22----2014/6/19

余远强: 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

张炜东: 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 (2)”。

胡晓博: 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 (2)”。

杨波: 详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 (2)”。

杨世红: 男, 1970年1月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1992年毕业于西安交通大学电子工程系, 获工科学士学位。毕业后至1993年在中航西安飞行自动控制研究所(618所)负责模拟电路板的设计和调试; 1994年至2009年7月在北电网络通讯工程有限公司从事通讯设备安装调试和技术支持; 2009年8月至2010年3月任西安众为通信技术有限公司副总经理; 2010年4月至2010年9月任陕西天盛新材料科技有限公司技术总监; 2010年10月加入有限公司, 并自加入至今任系统设计总监; 2013年5月当选本公司董事。

(二) 监事基本情况

公司本届监事会由三名监事构成, 全体监事任期均为三年。

序号	姓名	性别	年龄	现任职位	任职期限
1	陈楷华	男	70	监事会主席	2011/6/20----2014/6/19

2	冯晓波	男	43	监事	2011/6/20----2014/6/19
3	张江永	男	37	职工监事	2011/6/20----2014/6/19

陈楷华：男，1943年11月生，中国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1967年至1987年在兴平化肥厂工作，1987年至2003年在咸阳偏转集团工作，历任集团公司人事部长、集团公司副总经理、咸阳偏转股份有限公司总经理、咸阳偏转股份有限公司董事长，2004年1月从咸阳偏转股份有限公司退休。

冯晓波：男，1970年4月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1992年毕业于西安交通大学，获工业自动化学士学位；1998年毕业于西安交通大学，获自动化硕士学位。1998年至2001年，在华为电气股份有限公司任开发工程师、项目经理；2001年至今任艾默生网络能源公司开发副总经理、总经理、艾默生网络能源西安研发中心副总监。

张江永：男，1976年3月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月毕业于西北工业大学计算机应用专业。1999年8月至2010年3月间分别在北京伟之源公司任销售部经理、西安中芯微电子有限公司任版图设计工程师、陕西西科美芯科技集团有限公司任技术工程部经理、西安科技大学高新学院任实验中心主任，曾参与大规模图像协处理器芯片布局布线（国家863项目）、步进式电机细分驱动芯片、数显卡尺芯片，8位flash数模转换芯片等设计工作。2010年4月加入有限公司，并自加入至今任IC设计部部长，主要从事本公司电源类芯片版图设计和电路分析工作。

（三）高级管理人员基本情况

公司共有三名高级管理人员，均由股份公司第一届董事会第一次会议聘任。

序号	姓名	性别	年龄	现任职务
1	余远强	男	43	总经理
2	胡晓博	男	44	副总经理
3	陈 彬	女	43	董事会秘书、财务总监

余远强：详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“（二）主要股东情况 1、控股股东、实际控制人的基本情况”。

胡晓博：详见本说明书“第一章 基本情况”之“三、公司股权结构”中“(二) 主要股东情况 3、前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 (2)”。

陈彬：女，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。1992 年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。2005 年毕业于西北大学国际经济法专业，获法学硕士学位。1992 年至 2008 年间分别任西电集团重型电炉厂销售处销售员、陕西金叶科教集团物资供应部主管、陕西金叶科教集团进出口公司副总经理、上海瑞石实业投资有限公司财务总监、投资总监。2009 年 3 月至今任本公司财务总监及董事会秘书。

八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标

项目	2013. 6. 30	2012. 12. 31	2011. 12. 31
资产总计 (万元)	3, 495. 81	3, 141. 50	3, 456. 06
股东权益合计 (万元)	2, 193. 86	2, 090. 86	1, 852. 44
归属于申请挂牌公司的股东权益合计 (万元)	2, 193. 86	2, 090. 86	1, 852. 44
每股净资产 (元)	1. 83	1. 74	1. 54
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)	1. 83	1. 74	1. 54
资产负债率 (母公司) (%)	37. 24	33. 44	46. 4
流动比率 (倍)	1. 92	2. 29	1. 84
速动比率 (倍)	0. 74	0. 94	0. 95
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入 (万元)	1, 109. 32	2, 020. 09	3, 592. 94
净利润 (万元)	103. 00	238. 41	699. 62
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)	103. 00	238. 41	699. 62
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	108. 40	162. 50	823. 73
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	108. 40	162. 50	823. 73
毛利率 (%)	29. 47	25. 74	31. 03
净资产收益率 (%)	4. 81	12. 09	58. 17
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	4. 81	7. 27	58. 19

基本每股收益（元/股）	0.09	0.20	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.20	0.77
应收帐款周转率（次）	2.02	2.09	4.41
存货周转率（次）	0.59	1.12	2.79
经营活动产生的现金流量净额（万元）	153.18	1,220.55	-948.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	1.02	-0.79

九、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商	
名称	招商证券股份有限公司
法定代表人	宫少林
住所	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联系电话	0755-82943666
传真	0755-82943100
项目小组负责人	李玉萍
项目小组成员	赵丽娟（行业分析师）、李白才（律师）、廖凌雁（注册会计师）、尹为（项目小组成员）
（二）律师事务所	
名称	北京金诚同达律师事务所西安分所
法定代表人	方燕
住所	西安西高新沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 15 层
联系电话	029-62669150
传真	029-62669152
项目小组负责人	张宏远
项目小组成员	杨琦、陈凯
（三）会计师事务所	
名称	希格玛会计师事务所有限公司

法定代表人	吕桦
住所	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
联系电话	029-88275911
传真	029-88275912
项目小组负责人	范敏华
项目小组成员	范敏华、王侠
(四) 资产评估机构	
名称	西安正衡资产评估有限责任公司
法定代表人	雷华锋
住所	西安市高新区西部电子商城步行街群力大厦 401 室
联系电话	029-87515283
传真	029-87511349
项目小组负责人	余涛
项目小组成员	余涛、靳晓亮、郭强军
(五) 证券登记结算机构	
名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话	0755-25938000
传真	0755-25988122
(六) 证券交易所	
名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
法定代表人	杨晓嘉
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

第二章 公司业务

一、公司主营业务及主要产品

（一）主营业务

公司主营业务为先进的亚微米 BIPOLAR、CMOS、BICMOS、BCD 等工艺技术的数字模拟混合集成电路产品的设计、开发和销售；公司产品为应用于 LED 照明、网络通信、智能手机、平板电脑及电视机顶盒、计算机及计算机接口设备等多种电子产品的高转换效率、高可靠性、绿色节能电源管理芯片，终端用户遍布全球众多国家和地区。公司拥有由多名优秀电源管理芯片、系统设计专家组成的研发团队，为客户提供性价比较高的电源管理芯片、系统解决方案以及全方位的售后服务。目前，公司拥有 5 项专利技术和 13 项集成电路布图设计证书。

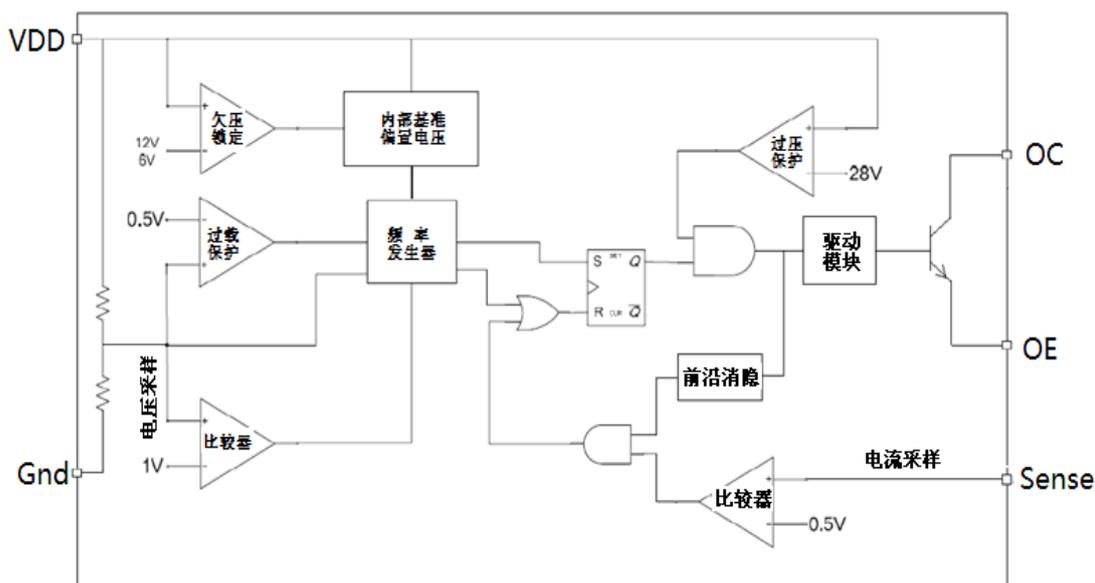
（二）主要产品及其用途

根据应用领域不同，公司产品分为 LED 照明驱动芯片和消费类电子用 AC/DC 转换芯片。其中，LED 照明驱动芯片主要包括 RM325X、RM337X、RM900X、RM901X 等系列产品，该类产品主要应用于 LED 球泡灯、灯管、吸顶灯、射灯及路灯的驱动等领域；消费类电子用 AC/DC 转换芯片主要包括 RM326X、RM327X、RM62XX 等系列产品，该类产品主要应用于计算机、网络通讯、机顶盒、平板电脑、智能手机等充电器或电源适配器开关电源领域。

1、LED 照明驱动芯片

（1）RM325X、RM337X 系列芯片

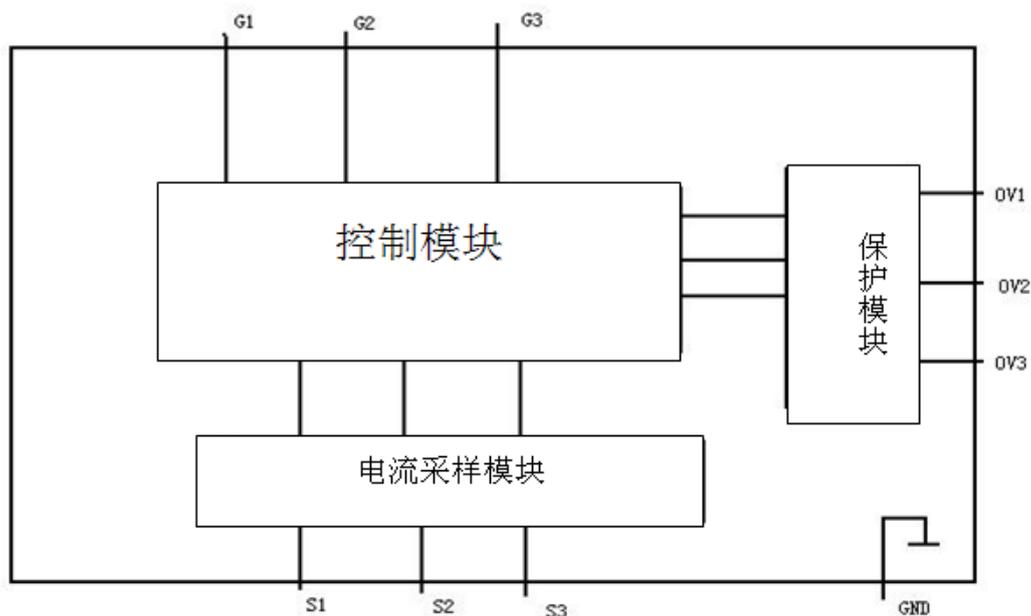
RM325X、RM337X 系列芯片是采用原边反馈反激拓扑结构、离线式频率调制（PFM）的 LED 照明驱动芯片，包括 RM3252/RM3253/RM3370/RM3371/RM3372/RM3373，主要应用于 LED 球泡灯、吸顶灯、射灯等领域。该系列芯片具备外围电路设计简单、低成本、高性能的特点。通过将 VDD 脚输入电压稳定在固定值来完成频率调制控制，内部集成欠压锁定（UVLO）、过流保护、VDD 过压保护等功能，这种频率调制（PFM）控制模式使其工作频率随着负载大小自动调节，负载越大频率越高。



产品架构示意图

(2) RM900X 系列芯片

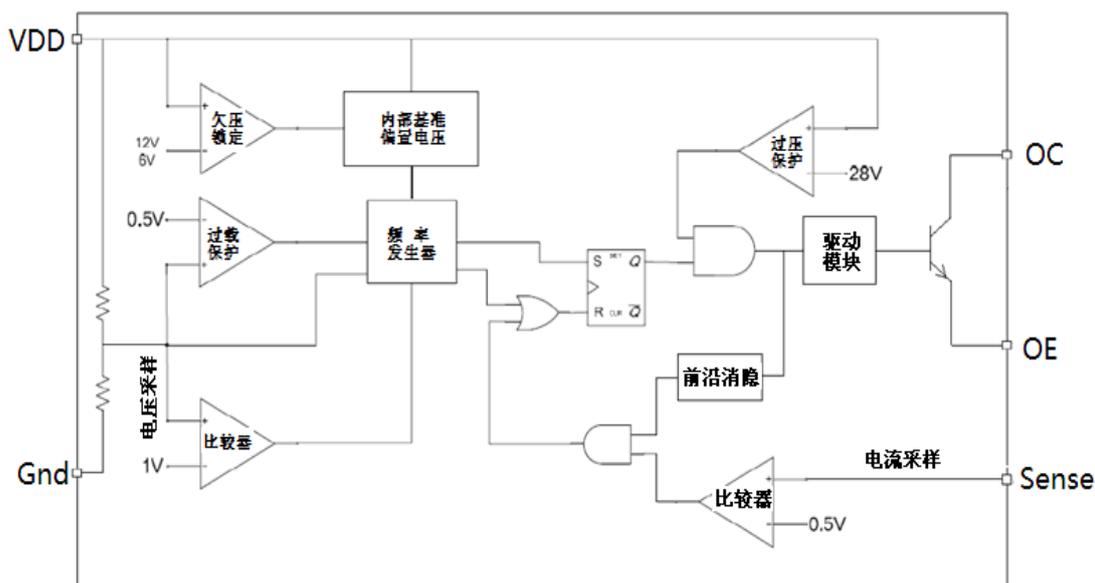
RM900X 系列是高精度线性恒流 LED 驱动芯片，包括 RM9000S、RM9001S、RM9002T、RM9003S 等产品，主要应用于 LED 球泡灯、灯管驱动。该系列芯片由于外围电路不需要电解电容和磁性元件，完全保障了 LED 驱动器小体积、长寿命的性能。该系列芯片采用自适应 LED 分段驱动机制，可以灵活设置每段 LED 串，适应不同地区的电压，从而提高 LED 利用率和总输出流明数。该系列芯片具有负温度系数设计，当芯片温度升高时输出电流会适当减小，从而达到电流和芯片温度的平衡，保护 LED 驱动器。



产品架构示意图

(3) RM901X 系列芯片

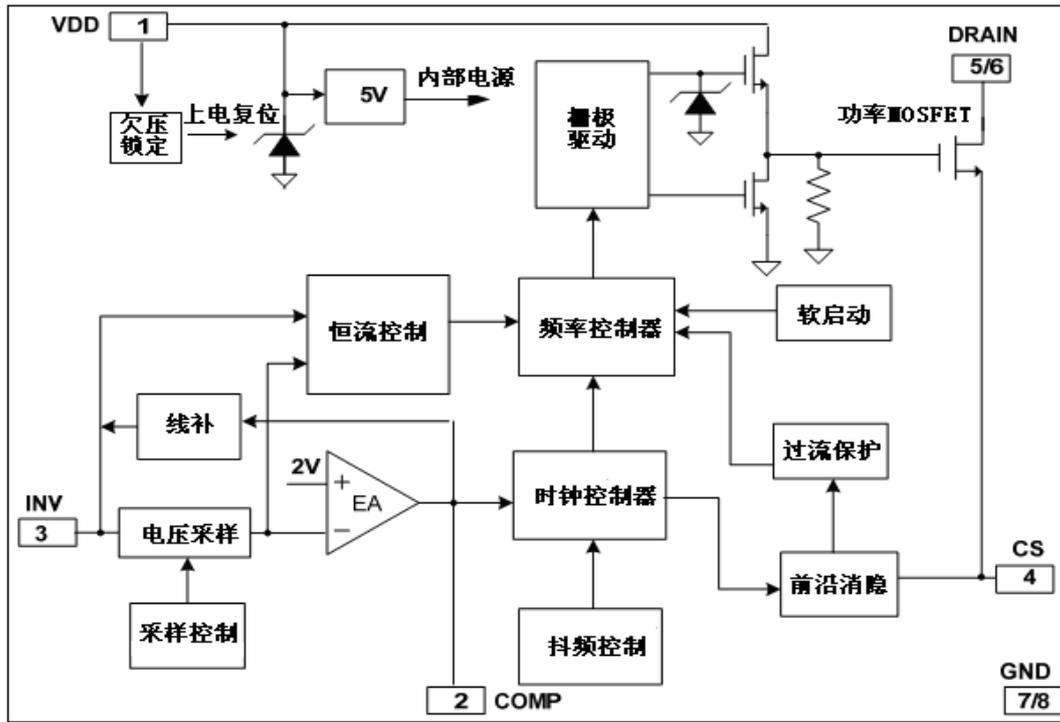
RM901X 是专用于非隔离方案 LED 照明驱动的控制芯片，包括 RM9010T 和 RM9018S 两种型号，主要适用于 LED 灯管、吸顶灯、射灯驱动等。该系列芯片在设计上采用降压（BUCK）拓扑，相对于隔离电源，外围电路设计简单、成本低、效率高。同时，采用频率调制（PFM）控制模式使其工作频率随着负载大小自动调节，负载越大频率越高。通过检测 VDD 脚输入电压来完成频率调制控制，当 VDD 电压高于 12V 时振荡器开始工作，随着 VDD 电压上升，频率也随之增大，直到 21V 时频率达到最大值 54Khz；当电压低于 6V 时，振荡器频率停止工作。



2、消费类电子用 AC/DC 转换芯片

(1) RM326X/RM327X 系列芯片

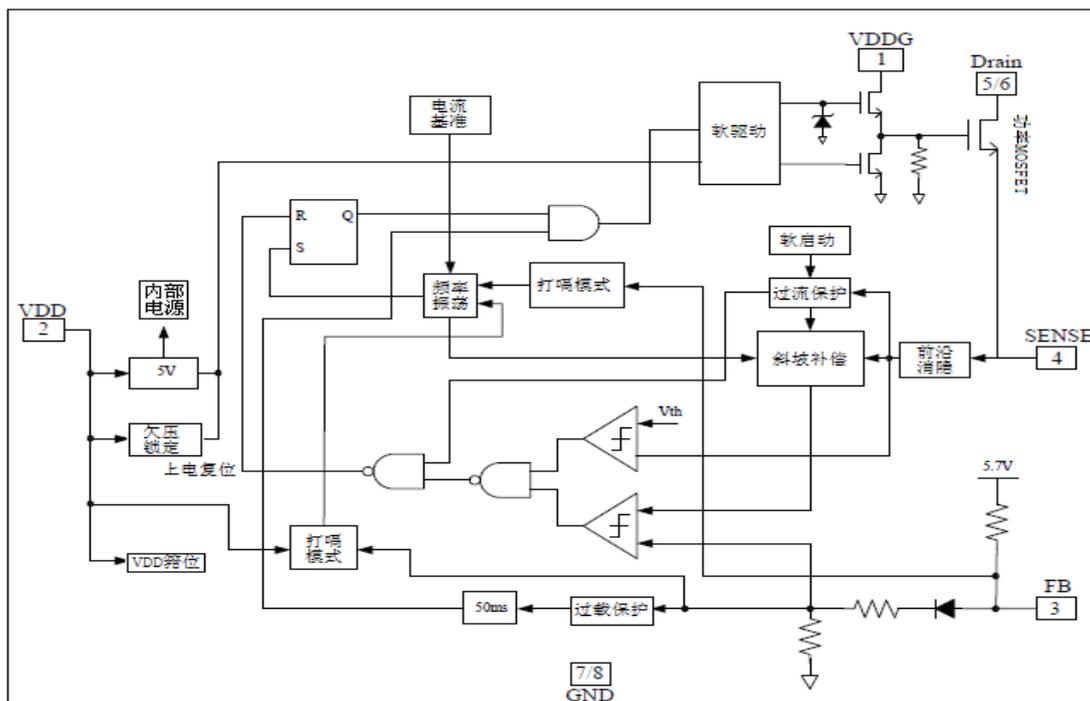
RM326X/RM327X 系列芯片是基于原边反激拓扑、离线式频率调制 (PFM) 电源管理芯片，主要应用于网络通讯、平板电脑、智能手机等小功率交流转直流充电器或电源适配器。该系列芯片采用内部集成高精度恒压和恒流控制器，可实现 ±5% 的精度。在恒流工作模式下，输出电流和输出功率都是通过 CS 脚外接的 RS 电阻来调节；在恒压工作模式下，INV 脚通过采样辅助绕组电压来稳定输出电压。该系列芯片在设计中集成软启动、逐周期电流限制、VCC 过压保护、VCC 过压箝位和欠压锁定等多种保护功能，同时内置抖频技术可提高抗 EMI 能力。



产品架构示意图

(2) RM62XX 系列芯片

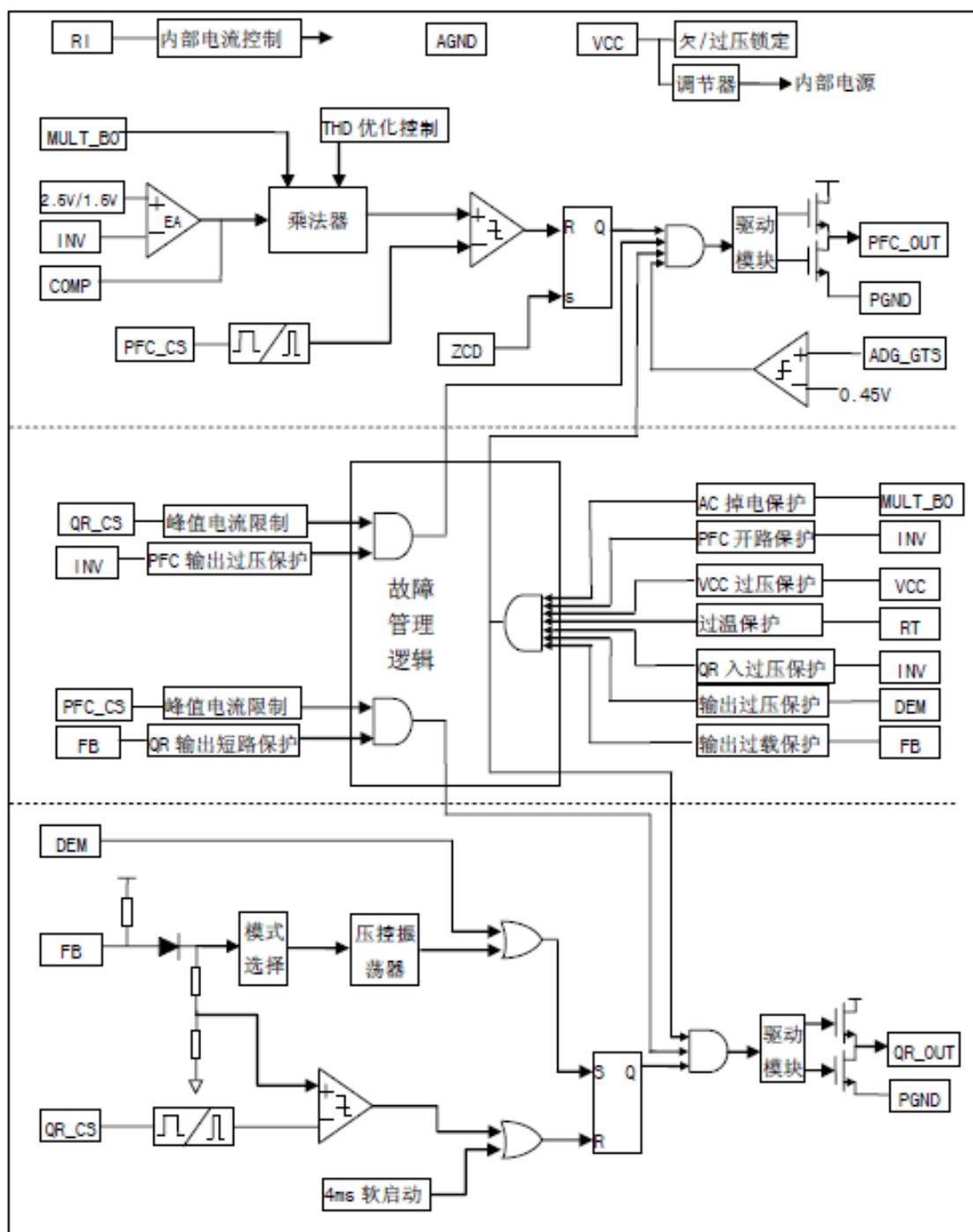
RM62XX 系列芯片是基于负边反激拓扑、离线式脉宽调制 (PWM) 的电源管理芯片, 包括 RM6203/RM6204/RM6220/RM6221/RM6222/RM6224。其中, RM6203 芯片是一款采用先进的过载和满载电流保护技术的开关电源管理芯片, 在全电压范围内连续提供 12W 的输出功率, 在单电压范围内功率可达 15W, 该设计最大程度减少了产品的总成本; RM6204 是在 RM6203 的基础上将 CT 脚外接电容集成到芯片内部, 减少了外部器件, 使客户使用更方便。该系列芯片内部启动电路采用独特电流吸入方式, 利用开关管自身放大作用完成启动, 这在很大程度上减少了启动电阻的损耗。该系列芯片内部设计了过载保护、输出短路保护、过温保护、VCC 过压保护等多款保护功能, 合理的设计最大程度地减少了产品成本; RM6220/RM6221/RM6222/RM6224 是一系列高性能电流模式 PWM 控制器, 内置不同高压 MOSFET 进一步提高了产品可靠性。优化的合理性电路设计最大程度节省了产品整体成本。离线式副边反馈应用, 单电压输入时最大输出功率可达 24W。



产品架构示意图

(3) RM6301/RM6401/RM6901/RM6562 系列芯片

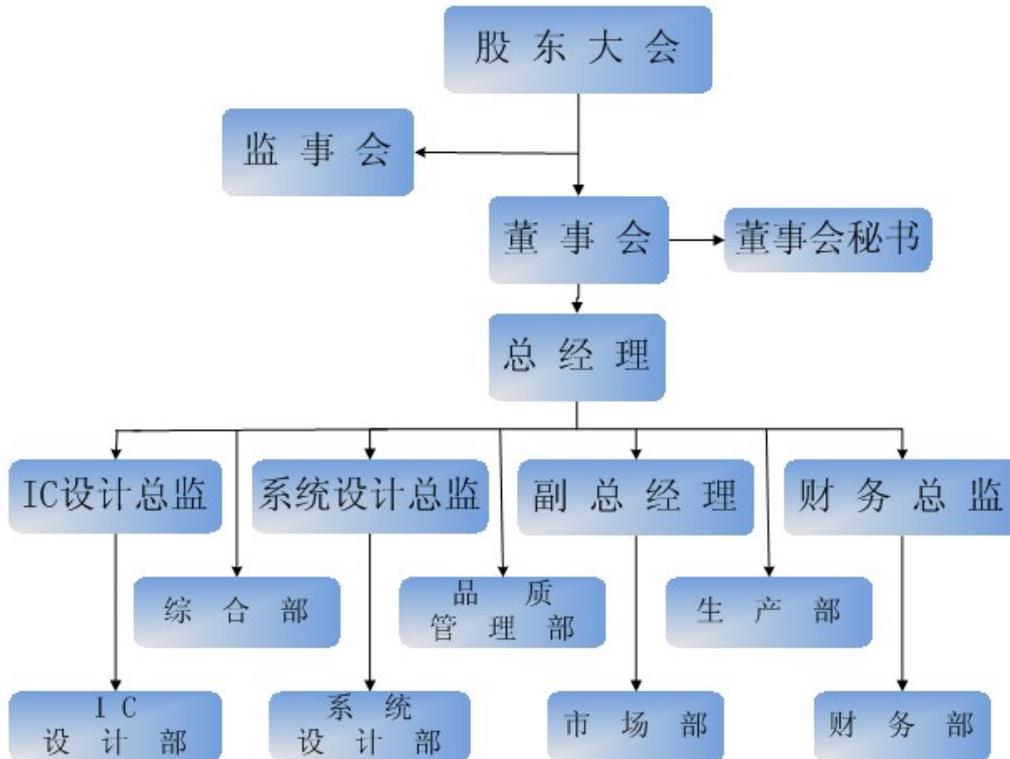
RM6301/RM6401/RM6901/RM6562 系列芯片是基于负边反激拓扑、离线式脉宽调制 (PWM) 的电源管理芯片，是公司特别针对满足 60W 至 100W 电源功率需求的各种性能而开发的系列产品，主要应用于计算机、电视机等电源适配器。其中，RM6301 是一款高度集成的电流模式 PWM 控制芯片，具有高性能、低待机功耗优点，为用户提供适用于反激式副边反馈开关电源的简单设计电路和低成本解决方案；RM6401S 是一款高性能反激式准谐振控制器芯片，优化的合理性设计实现了在全电压输入、满载输出时高效率工作，具有系统设计简单、性价比高的优点；RM6901 是一款高性能临界导通模式功率因数校正和准谐振组合的控制器芯片，临界导通模式功率因数校正提供了低成本的具有低失真和高功率因数的系统解决方案；RM6562 是一款临界导通模式的功率因数校正芯片，其内部有一个独立的启动定时器应用程序，高性能模拟乘法器用于保证接近于 1 的功率因数和较低的 AC 输入电流谐波失真 (THD<5%)。



产品架构示意图

二、公司组织结构及主要生产流程

(一) 组织结构



（二）主要生产流程

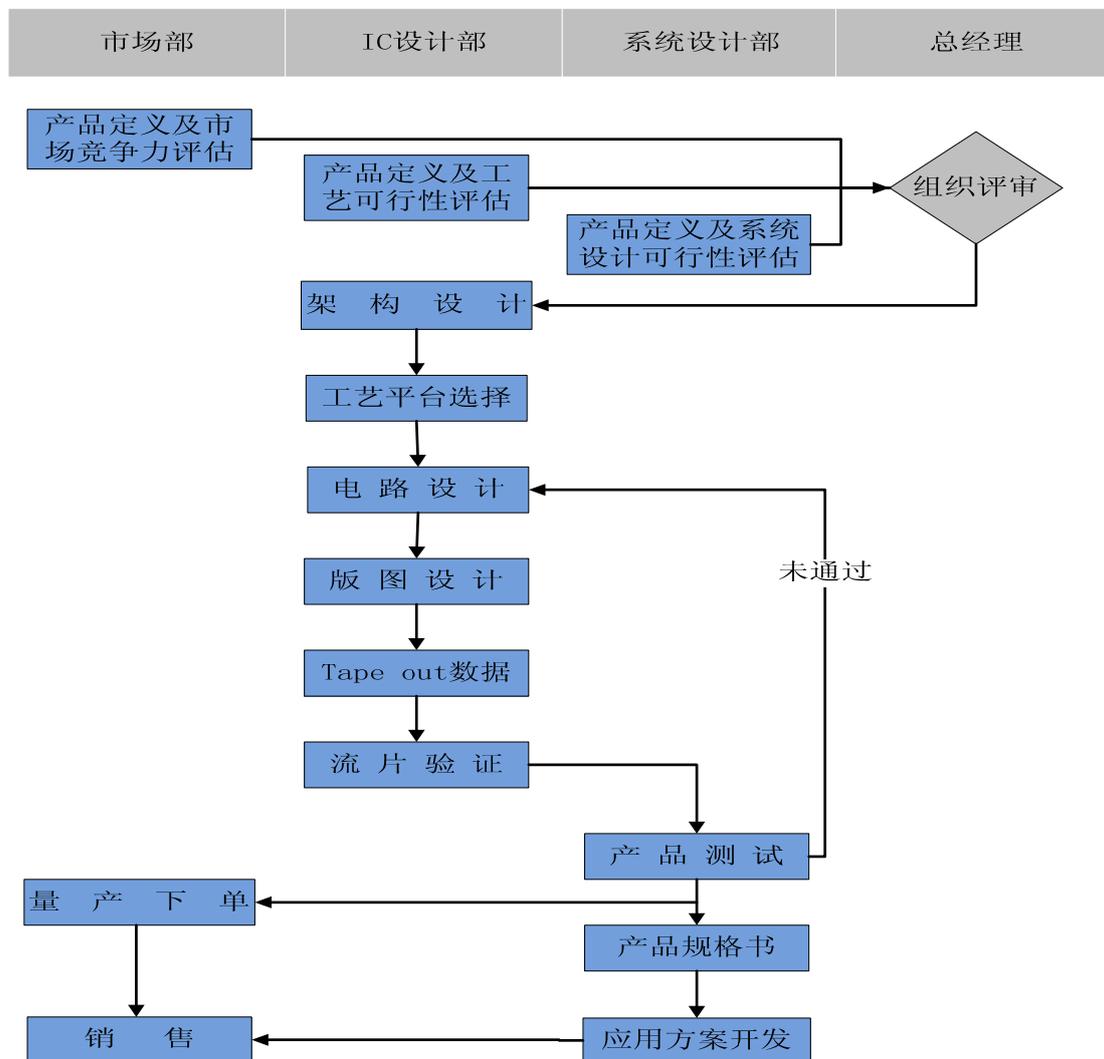
集成电路行业的企业根据所处产业链的不同环节，主要分为 IC 设计、IC 制造和 IC 封装测试三类企业。公司作为集成电路行业中的无生产线（Fabless）设计企业，所有量产产品均通过委托加工方式实现，所以公司主要生产流程包括产品研发、委托加工、销售三个环节。

1、研发流程

公司采用了 Fabless 模式运营，即将集成电路的晶圆生产、封装测试外包，专注于集成电路设计，符合集成电路垂直分工产业链的特点，也符合国际市场上集成电路设计占整个行业产值比重愈来愈高的发展趋势。同时由于无生产线负担，专注于设计业务，具有灵活性、市场灵敏度高等特点。公司目前主要根据终端产品市场需求，将抽象的产品设计要求转化为特定元器件组合，并通过委托加工形成公司芯片产品。

在研发方面，公司根据终端产品市场需求，首先通过对客户需求分析，定义产品功能和性能指标；其次，由公司总经理组织对产品定义及其市场竞争力、

工艺可行性、系统设计可行性进行评估和评审，评审通过后进行架构设计；再次，根据对产品具体参数的要求选择委托加工的工艺平台，同时公司研发人员进行电路设计，将其转化为集成电路版图数据。具体研发流程图如下：



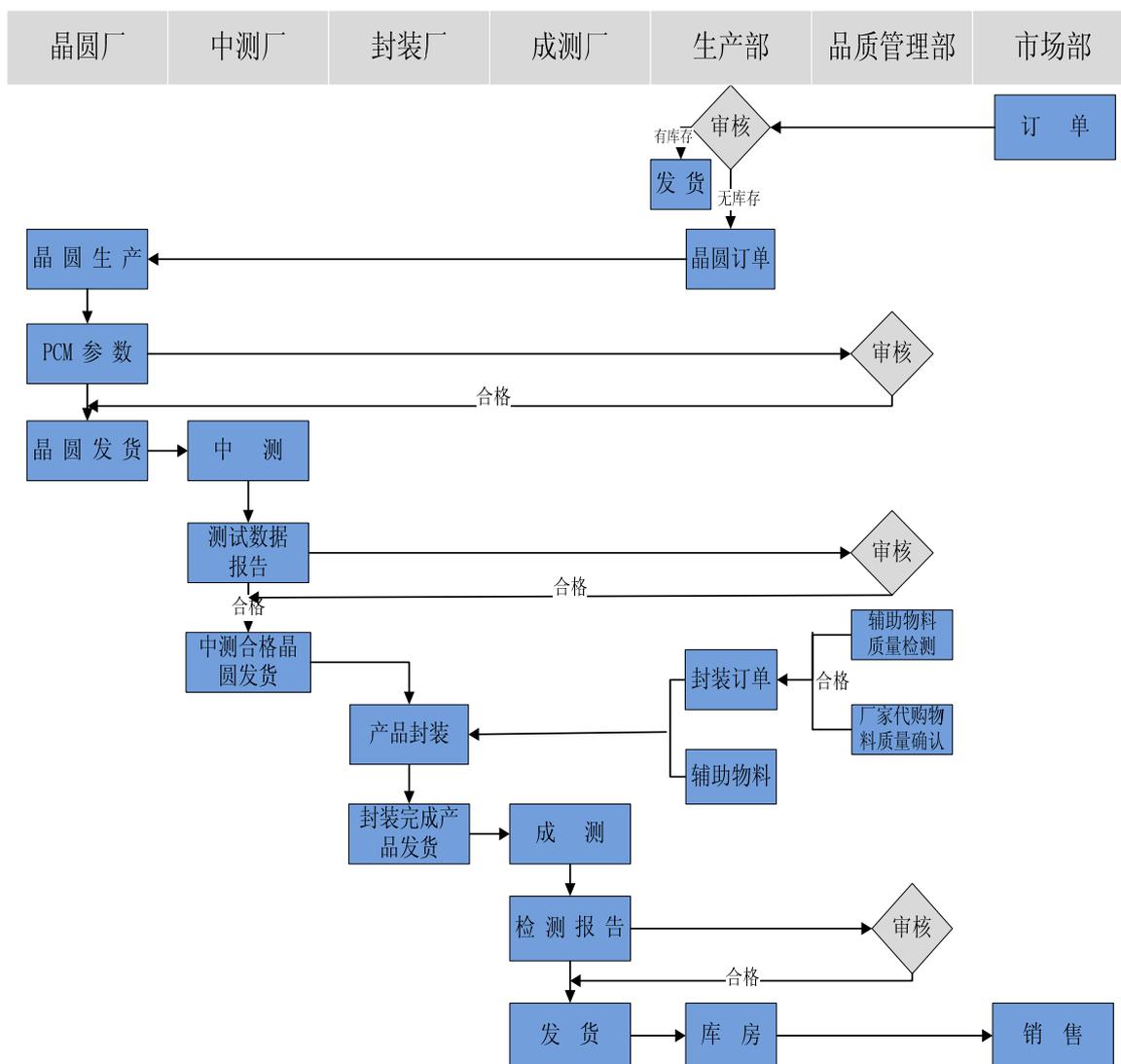
研发流程图

2、产品实现流程

产品实现流程主要包括晶圆代工、封装测试等委托加工环节。其中，晶圆代工指根据委托企业的 IC 设计，将设计刻录在晶圆上，收取代工费；封装测试企业将制作好的晶圆进行切割并封装形成最终 IC 产品。目前公司已经与台湾汉磊、华天科技等集成电路代工企业建立了稳定合作关系，委托其进行晶圆加工、封装加工以及芯片中测、成测。

从生产流程上来看，公司作为 IC 设计企业根据终端电子产品需求进行集成

电路布图设计，公司产品订单通过生产部审核后，委托晶圆加工厂进行晶圆代工、芯片封装厂封装测试，具体委托加工步骤包括：①公司提供版图和光罩，由晶圆厂加工成晶圆；②晶圆厂将加工完成的晶圆交由中测厂进行质量测试；③测试合格的产品交由封装厂进行封装，加工成为芯片；④芯片交由成测厂进行成品质量测试。

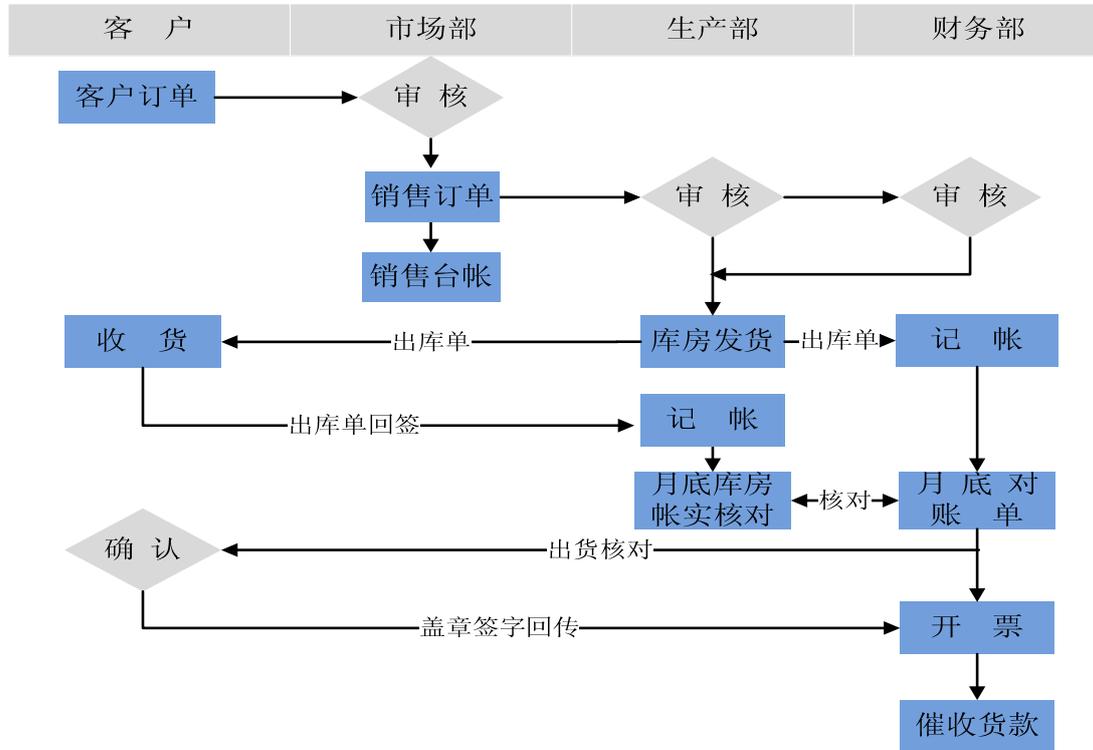


产品实现流程图

3、销售流程

公司采取直销和分销相结合的销售模式，即以经销商代理销售为主、直接销售为辅的模式销售产品，并与主要经销商建立了稳定合作关系。在集成电路行业中，IC 产品种类繁多，可以应用于广泛的终端行业，客户规模大小不一，

通过引入规模较大的经销商，不仅能够增强公司的销售能力，而且通过对经销商进行反馈信息收集，公司能够更全面掌握市场变化并分析了解终端客户的需求，在此基础上更新现有产品设计和研发新产品。



销售流程图

三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 产品使用的主要技术

公司产品的技术含量主要体现在集成电路的系统设计、电路仿真验证、版图设计与验证等方面。集成电路设计是根据电路功能和性能的要求，在正确选择功能配置、电路形式、器件结构、工艺方案和设计规则的情况下，尽量减小芯片面积，降低设计成本，缩短设计周期，以保证全局优化，设计出满足要求的集成电路。公司产品采用的主要技术如下：

1、采用 Burst model

公司的电源管理集成电路普遍采用跳频模式，俗称“打嗝模式”。在电源轻载或空载状态下，集成电路内部振荡器可自动调整为间歇震荡状态，降低功率管开关次数，减小开关管开关工作时变压器的充能，从而减小 PWM 或 PFM 的

调整压力，拓宽开关电源负载调整范围以及输入电压范围，提高负载调整率和电压调整率。同时，也大大降低电源轻载或空载功耗。

2、采用软启动技术

在开关电源中需要使用容量较大的电解电容进行滤波，在电源通电瞬间，这些电容要进行充电，这样就会产生一个很大的电流，称之为浪涌电流，再加上有时要带载开机，浪涌电流会达到电源正常工作时的 10~100 倍，这有可能产生三个方面的问题：第一，开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动；第二，这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低，足以引起使用同一输入电源的其它设备瞬间掉电；第三，对电网造成污染，电源通过安规测试变得困难。传统的开关电源常常在交流输入端串接一个具有负温度系数的热敏电阻，利用其低温大电阻特性降低浪涌电流。这种简单的方法具有 NTC 电阻器的限流效果受环境温度影响较大、限流效果在电源短暂停电重复启动时只能部分地达到、NTC 电阻器的功率损耗降低了开关电源的转换效率等不足。公司产品在设计时增加软启动电路，在电源开机瞬间，电源主功率管并不马上导通，这样电源次级电容不会在开机瞬间充电，也相当于在开机瞬间负载短时退出，从而避免出现大的浪涌电流，在很多情况下，电源可以省去价格较贵的热敏电阻，节约成本，提高效率。

3、采用频率抖动技术

在固定频率 PWM 控制器中，窄带发射通常发生在开关频率，其连续谐波的能量会越来越低。公司采用频率抖动技术来分散谐波干扰能量，使得开关电源的工作频率并非固定不变，而是周期性地变化，由于 EMI 发射分布在较广的频率范围而不是在窄带频率下工作，因此可降低 EMI 发射的峰值。抖动振荡器也将降低谐波频率(即为开关频率倍数的频率)的峰值。因此公司设计的电源管理芯片容易通过电磁兼容测试。

4、采用集成 PFC 技术

由于开关电源都是在整流后，用一个大容量的滤波电容使该用电器具的负载特性呈现容性，这就造成了交流 220V 在对该用电器具供电时，由于滤波电

容的充、放电作用，在其两端的直流电压上出现略呈锯齿波的纹波。滤波电容上电压的最小值远非为零，与其最大值（纹波峰值）相差并不多。根据整流二极管的单向导电性，只有在 AC 线路电压瞬时值高于滤波电容上的电压时，整流二极管才会因正向偏置而导通，而当 AC 输入电压瞬时值低于滤波电容上的电压时，整流二极管因反向偏置而截止。也就是说，在 AC 线路电压的每个半周期内，只是在其峰值附近，二极管才会导通；虽然 AC 输入电压仍大体保持正弦波波形，但 AC 输入电流却呈高幅值的尖峰脉冲。这种严重失真的电流波形含有大量的谐波成份，引起线路功率因素严重下降。

自从用电器具从过去的感性负载（早期电视机、收音机等电源均是采用电源变压器的感性器件）变成带整流及滤波电容器的容性负载后，其功率因素补偿的含义不仅是供电的电压和电流不同相位的问题，更为重要的是要解决因供电电流呈强脉冲状态而引起的电磁干扰（EMI）和电磁兼容（EMC）问题。为解决因容性负载导致电流波形严重畸变而产生的电磁干扰和电磁兼容问题，公司采用与过去功率因素补偿技术完全不同的 PFC 技术。该技术是针对非正弦电流波形畸变而采取的，迫使交流线路电流追踪电压波形瞬时变化轨迹，并使电流和电压保持同相位，使系统呈纯电阻性的技术（线路电流波形校正技术），可使功率因素校正效果达到 99% 以上。

5、低待机功耗处理

公司设计的集成电路内部采用降低芯片工作电压、减小芯片待机时工作电流以减少待机时的芯片功耗，使用高压启动减小启动电阻的功耗，采用降低待机时芯片的开关频率或 BurstMode 模式，以及采用提高空载电压调整率等技术使电源整机在待机时功耗较低。

6、采用线电压补偿技术

在充电器和适配器应用中，由于输出线一般都较长，当输出电压为低电压大电流时，输出线上的电压下降会对输出电压有较大影响，所以一般只能采用较大直径的输出线，大大增加了产品成本。公司采用输出线电压补偿技术，在输出大电流时输出电压得到一定程度的补偿，从而保证输出电压的稳定，而不需要增大输出线的直径。

7、采用线性恒流技术

目前 LED 灯具普遍使用开关电源作为驱动器，但开关电源具有寿命短、技术复杂和成本高等缺点，致使 LED 灯具的价格较高。线性恒流驱动技术具有电流可调节、可靠性高和成本低的优点，可以大幅度降低 LED 灯具的价格。

(1) 采用多段 LED 驱动技术

多段 LED 驱动技术可以解决线性恒流驱动技术效率低和功率因数低的缺点，该技术采用多个 LED 发光单元串联组成 LED 串的技术，随电压升高逐段开始导通点亮，可以提高 LED 的导通时间增加 LED 串的发光效率。

(2) 采用负温度系数设计

为了提高芯片工作的可靠性，高压线性 LED 驱动芯片采用负温度系数设计。当芯片的温度升高时工作电流会适当减小，最后达到平衡，以防止温度过高芯片损坏。

(3) 过压保护电路

当输入电压波动较大时或 LED 串出现短路或开路时，驱动电路中的功率管漏极上会承受最大超过 100v 的电压，同时由于功率管工作在线性区，如果长时间工作在过压情况下容易损坏功率管。公司应用过压保护电路技术，在功率管漏极的电压超过预设保护电压值时芯片会关断所有驱动功率管，当电压降到预设保护电压值以下时再重新恢复到以前的状态。

8、高可靠性设计技术

公司的产品多应用于比较恶劣的交流供电环节，静电瞬态电流容易造成电路板和器件损伤，电网波动也会引起电路的误动作，这些在客观上要求所设计出的集成电路产品具有更高可靠性。公司开发的静电泄放保护电路能够有效防止静电对芯片的损伤，按照行业标准衡量，ESD（静电释放）指标在 4000V~8000V，Latchup（闩锁效应）指标在 400mA 以上。公司自有的 ESD 保护电路技术，能够有效提高芯片对空间辐射或电源瞬变的抗干扰能力，EFT（电快脉冲群）指标在 4000V 以上。

公司的核心技术来自公司核心技术团队的自主研发，以及对现有成熟技术的整合应用，公司产品使用的主要技术已经通过电路模块设计、晶圆生产、产品检测等环节得以验证。

（二）主要无形资产情况

1、专利技术

（1）已授权专利技术

截至本说明书签署之日，公司拥有 5 项专利技术获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《专利证书》。具体如下表所示：

获得授权的专利技术列表

序号	专利名称	专利类型	专利号	发明人	专利权人	取得方式	申请日期	授权日	保护期
1	一种具有渐进式电流过载与饱和防止功能的开关电源	发明专利	ZL200910023574.X	余远强	亚成微电子	原始取得	2009.08.12	2013.07.27	20年
2	线性高压 LED 驱动器保护电路	实用新型	ZL201220708512.X	杨波 杨世红	亚成微电子	原始取得	2012.12.20	2013.07.17	10年
3	一种 LED 光源	实用新型	ZL201320007217.0	杨波 杨世红	亚成微电子	原始取得	2013.01.08	2013.07.17	10年
4	适用线性高压 LED 驱动器的调光电路	实用新型	ZL201320021348.X	杨波 杨世红	亚成微电子	原始取得	2013.01.16	2013.08.14	10年
5	一种 LED 发光模组	实用新型	ZL20132007272.5	杨波 杨世红	亚成微电子	原始取得	2013.01.08	2013.07.31	10年

（2）正在申请的专利技术

截至本说明书签署之日，公司正在申请且已收到受理通知书的专利技术有 6 项。具体如下表所示：

正在申请的专利技术列表

序号	权利名称	权利类别	申请人	申请日期	申请号	受理单位
1	线性高压 LED 驱动器保护电器	发明专利	亚成微电子	2012.12.20	201210556930.6	中华人民共和国国家知识产权局
2	一种 LED 发光模组	发明专利	亚成微电子	2013.1.8	201310005340.9	中华人民共和国国家知识产权局
3	一种 LED 光源	发明专利	亚成微电子	2013.1.8	201310005376.7	中华人民共和国国家知识产权局
4	适用线性高压 LED 驱动器的调光电路	发明专利	亚成微电子	2013.1.16	201310014971.7	中华人民共和国国家知识产权局
5	一种线性高压 LED 驱动电路	发明专利	亚成微电子	2013.6.7	201310223972.2	中华人民共和国国家知识产权局
6	一种线性高压 LED 驱动电路	实用新型	亚成微电子	2013.6.7	201320325724.4	中华人民共和国国家知识产权局

2、商标权

截至本说明书签署之日，公司有 4 项商标获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》。具体如下表所示：

已核定的商标列表

序号	商标名称	核定使用商品类别	申请号	注册有效期	注册人
1	 REACTOR Microelectronics 亚成微电子	第9类	8828345	2011.11.28-2021.11.27	亚成微电子
2	 REACTOR Microelectronics	第9类	8828346	2011.11.28-2021.11.27	亚成微电子
3	 亚成	第9类	8828348	2011.11.28-2021.11.27	亚成微电子
4		第9类	8828347	2013.05.28-2023.05.27	亚成微电子

3、集成电路布图设计专有权

公司根据《集成电路布图设计保护条例》申请并获得授权的集成电路布图设计登记证书有13项，布图设计权利人为陕西亚成微电子股份有限公司。布图设计专有权的保护期为10年，自布图设计登记申请之日或在世界任何地方首次投入商业利用之日起算，以较前日期为准。但是，无论是否登记或投入商业利用，布图设计自创作完成之日起15年后，不再受该条例保护。

集成电路布图设计登记证书列表

序号	布图设计名称	布图设计登记号	申请日	授权公告日	取得方式	使用情况	是否存在纠纷
1	RM6513 降压型 PWM 控制芯片	BS.0850005 3.1	2008.3.4	2008.6.1 6	自主研发	正常使用	否
2	RM1981 升压型白光 LED 驱动器	BS. 0850005 4. X	2008.3.4	2008.6.1 6	自主研发	正常使用	否
3	高性能电流模式 PWM 开关电源控制芯片 RM6203	BS. 0950051 2. 9	2009.9.7	2009.12. 17	自主研发	正常使用	否
4	AC/DC 反激式开关电源芯片 RM6501	BS. 0950051 1. 0	2009.9.7	2009.12. 17	自主研发	正常使用	否
5	灌电流/源电流为 2A 的总线终端线性调解器芯片 RM9199A	BS. 0950051 3. 7	2009.9.7	2009.12. 17	自主研发	正常使用	否
6	隔离式 AC/DC 开关电源芯片 RM6506	BS. 0950051 0. 2	2009.9.7	2010.1.2 8	自主研发	正常使用	否
7	高性能开关电源芯片 RM6224	BS. 1050057 8. 9	2010. 9. 3	2010.12. 7	自主研发	正常使用	否
8	高性能 LED 恒流驱动芯片 RM3252	BS. 1050058 0. 0	2010.9.3	2010.12. 7	自主研发	正常使用	否
9	高精度原边驱动芯片 RM3262	BS. 1050057 9. 7	2010.9.3	2010.12. 7	自主研发	正常使用	否
10	高性能离线 (offline) 式准谐振 PWM 控制芯片 RM6401	BS.1050092 9.6	2010.12. 23	2011.3.2 3	自主研发	正常使用	否
11	高性能临界导通模式功率因子校正/准谐振组合控制芯	BS. 1150077 3. 3	2011.8.1 2	2011.11. 8	自主研发	正常使用	否

	片 RM6901						
12	临界导通模式功率 因数校正芯片 RM6562	BS.1250144 7.3	2012.11. 2	2013.1.8	自主研发	正常使用	否
13	高性能电流模式 PWM 芯片 RM6301	BS.1250144 8.1	2012.11. 2	2013.1.8	自主研发	正常使用	否

4、域名

公司的域名情况统计表

序号	证书	域名	所有者	有效日期
1	ICP 备案证书	reactor-micro.com	亚成微电子	2007.01.31- 2016.01.31

(三) 业务许可资格（资质）情况

公司在经营发展中先后取得的各类业务资质和荣誉证书详见下表：

公司经营现有业务的资质及荣誉证书列表

序号	资质/证书 名称	颁发机构	证书编号	颁发日期	有效期/ 执行期限	备注
1	高新技术企业	陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局	GF201261000259	2012年10月22日	2012.10.22- 2015.10.21	有效期三年，期满前三个月内提出复审申请。
2	集成电路设计企业认定证书	中华人民共和国工业和信息化部	工信部电子认 0583-2012C	2012年12月18日	采取年审制度，每年2月份之前完成年审即有效。	公司符合《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》
3	国家重点新产品证书	中华人民共和国科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局	2010GRG01016	2010年5月	2010.5- 2013.5	有效期三年，项目名称：结合有源 PFC 技术的新型 LED 照明驱动芯片 RM6513
4	科技型中小企业技	科学技术部 科技型中小	国科发计 [2012]778号	2012年7月	执行期限： 2012.7-	创新基金支持 项目名称：采

	术创新基金立项证书	企业技术创新基金管理 中心			2014.7	用有源 PFC 技术的新型 LED 照明驱动芯片
5	质量管理体系认证证书	北京天一认证中心	02612Q20218ROS	2012年4月12日	2012.4.12-2015.4.11	有效期三年
6	科技型中小企业技术创新基金立项证书	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理 中心	2009年6月25日	国科发计字 [2009]276号	执行期限: 2008.09.09-2010.09.09	创新基金支持项目名称: 高压高效率宽范围 PWM/PFM 双模调制型 DC/DC 转换器集成电路
7	创新基金验收证书	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理 中心	2011年5月13日	11-0363	-	承担的创新基金项目通过验收
8	2010年陕西省“13115”科技创新工程	陕西省科技厅	陕财办教 [2010]84号文件 2010ZDKG-28	2009年11月5日	执行期限: 2009.11-2010.11	项目名称: 采用有源 PFC 技术的新型 LED 照明驱动
9	西安市高新技术产业发展专项	西安市科技局、西安市财政局	市科发【2012】29号	2012年6月14日	执行期限: 2012.1-2014.12	承担“高效能 LED 照明驱动器”项目

(四) 特许经营权情况

公司目前无特许经营权。

(五) 重要固定资产情况

公司固定资产包括机器设备、办公及电子设备和其他设备三类。截止 2013 年 6 月 30 日，其账面价值占比分别为 53.57%、5.53%和 40.90%。其中机器设备主要是公司产品的研发、检测设备，办公及电子设备和其他设备为公司运营辅助设备。

2013 年 6 月 30 日固定资产情况表

项目	金额（元）	占比
----	-------	----

一、固定资产原值合计	1,909,062.16	
1、机器设备	1,172,281.91	61.41%
2、办公及电子设备	95,156.85	4.98%
3、其他设备	641,623.40	33.61%
二、固定资产账面值合计	1,402,419.20	
1、机器设备	751,227.99	53.57%
2、办公及电子设备	77,574.37	5.53%
3、其他设备	573,616.84	40.90%

公司作为集成电路行业无生产线的设计企业，其核心竞争力体现在电源管理器芯片的设计、研发与测试环节，生产环节全部外包完成，公司不需要投入过多的加工用生产设备，公司现有的生产设备主要用于试验设备的模拟运行及参数检测。

公司机器设备（生产设备）基本情况表

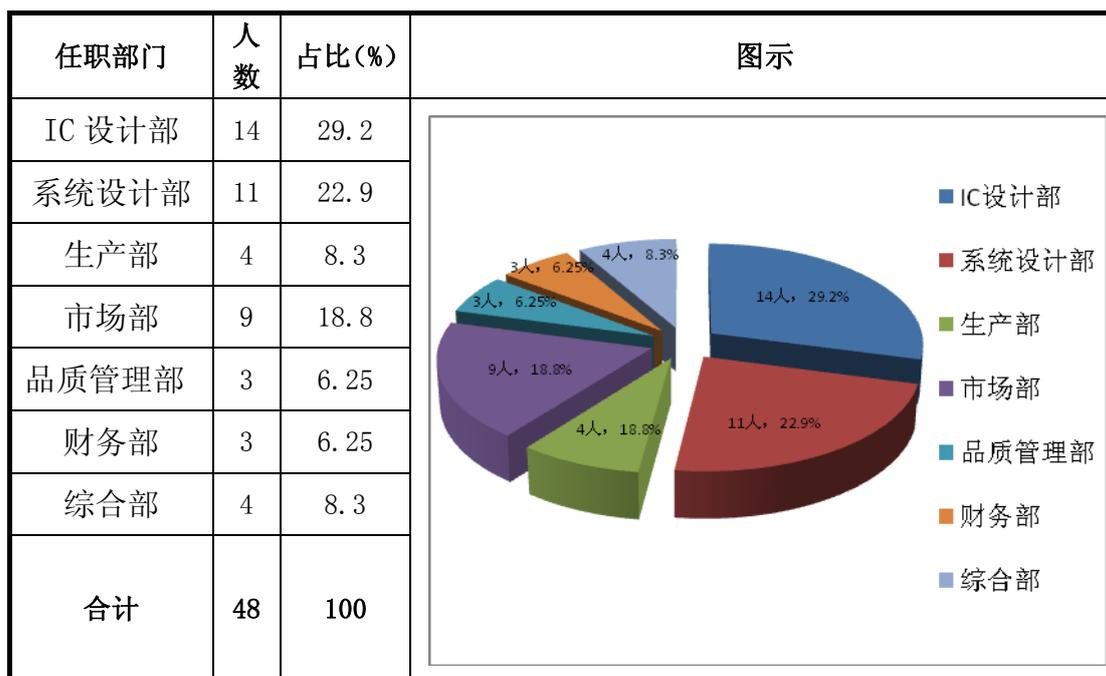
序号	1	2
设备/固定资产名称	测试工装	sun 工作站
数量	1	4
购买日期	2009年8月29日	2009年11月30日
资产账面原值	165,000.00	160,000.00
资产账面净值	108,075.00	108,400.00
用途	测试	研发
开工率	100%	100%
所有权人	陕西亚成微电子股份有限公司	陕西亚成微电子股份有限公司

（六）员工情况

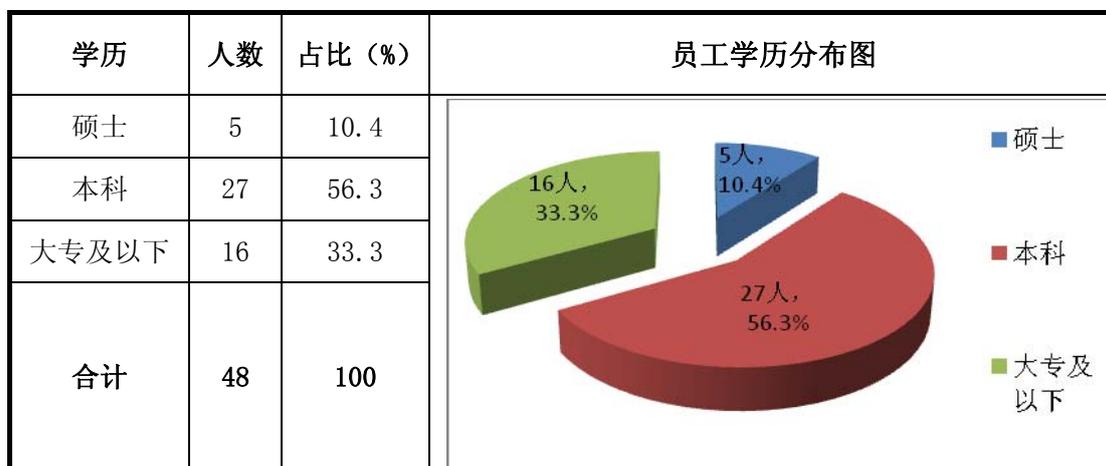
1、员工基本情况

截至2013年6月30日，公司共有员工48名。构成情况如下：

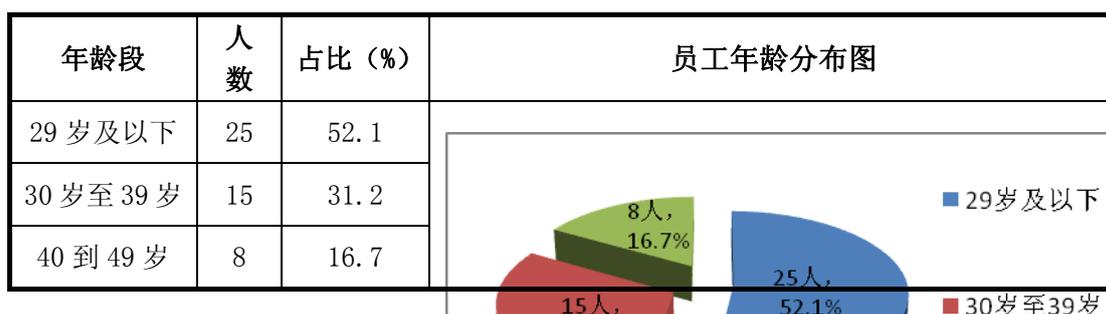
（1）任职分布：公司有芯片设计部14人，系统设计部11人，生产部4人，市场部9人，品质管理部3人，财务部3人，综合部4人。如下表所示：



(2) 学历分布：公司员工中具有硕士学位的 5 人，本科学历 27 人，大专及以上学历 16 人。学历结构图如下：



(3) 年龄分布：公司 29 岁及以下员工 25 人，30 岁至 39 岁员工 15 人，40 岁至 49 岁员工 8 人。人员结构图如下：



合计	48	100	
----	----	-----	--

2、核心技术人员情况

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例
1	余远强	43	1992年毕业于西安交通大学电子工程系。1992年至1998年在咸阳偏转集团公司工作，历任研发部研发工程师，集团子公司威海大宇电子项目部长，CIMS系统开发组长，集团公司副总；1999年至2006年在上海环信投资咨询公司工作，执行董事，投资分析工程师；2007年至今任公司董事长兼总经理。	董事长、总经理	长期	58.38%
2	杨波	37	2002年毕业于西安科技大学，获硕士学位。2002年至今在西安科技大学电控学院从事教学科研工作。2001年至2007年分别在西安中芯微电子技术公司、陕西美欧电信微电子技术有限公司、北京时代民芯微电子技术有限公司从事集成电路产品研发工作。2008年至今任公司IC设计总监。	IC设计总监	长期	2.5%
3	杨世红	43	1992年毕业于西安交通大学电子工程系，1992年起在中航西安飞行自动控制研究所（618所）工作，负责模拟电路板的设计和调试；1994年至2009年在北电网络通讯工程有限公司负责通讯设备安装调试和技术支持工作；2009年8月至2010年3月担任西安众为通信技术有限公司副总经理；2010年4月至2010年9月担任陕西天盛新材料科技有限公司技术总监；2010年10月至今任公司系统设计总监。	系统设计总监	长期	0.67%
4	赵军亚	45	1992年7月毕业于西安交通大学电子工程系，获工科学士学位，毕业后一直在西安交通大学从事教学科研工作，主要技术方向为开关电源设计和自动化控制系统设计。1996年9月至1999年7月在西安交通大学自控系完成硕士研究生课程学习。1995年4月加入中国电源学会，1999年3月起担任中国电源学会理事。2008年7月至今任公司系统设计部产品经理。	产品经理	长期	1.5%

5	张江永	37	1999年7月毕业于西北工业大学计算机应用专业。1999年8月至2010年3月间分别在西安中芯微电子有限公司任版图设计工程师、陕西西科美芯科技集团有限公司任技术工程部经理、西安科技大学高新学院任实验中心主任。曾参与大规模图像协处理器芯片布局布线(国家863项目)、步进式电机细分驱动芯片设计、数显卡尺芯片,8位flash数模转换芯片等设计工作。2010年4月至今任公司IC设计部部长。	IC设计部部长	长期	0
---	-----	----	--	---------	----	---

3、核心技术(业务)团队在近两年一期内发生重大变动的情况和原因

最近两年一期内,公司核心技术人员保持稳定,未发生重大变化。

(七)其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司业务经营情况

(一)业务收入构成及产品的销售情况

公司业务收入主要来源于消费类电子用AC/DC转换芯片和LED照明驱动芯片两类产品的销售。最近两年一期,公司业务收入的构成及占营业收入比例如下表所示:

业务类别	2013年6月30日		2012年		2011年	
	销售收入 (万元)	占比(%)	销售收入 (万元)	占比(%)	销售收入 (万元)	占比(%)
消费类电子用AC/DC转换芯片	930.25	83.86	1,795.66	88.89	2,365.77	65.85
LED照明驱动芯片	179.07	16.14	224.43	11.11	1,227.17	34.15
合计	1,109.32	100	2,020.09	100	3,592.94	100

2012年度与2011年度相比,销售收入下降43.78%,主要原因有以下几个方面:

(1)公司自2010年起研发LED照明驱动芯片相关产品,并于2011年度实现

量产后投入市场，获取了较好的销售收入。但由于LED照明市场作为一个新的正在发展过程中的市场，在市场标准、技术及客户需求方面都存在很多不确定性。公司2011年研发的LED照明驱动芯片相关产品质量和性能标准较高，但由于行业标准尚未统一，客户在选择产品上更多的倾向于质量和性能相对较低且成本较低的产品，因此公司2012年度的LED照明驱动芯片销量降低。

(2) 公司的主要供应商之一上海贝岭微电子制造有限公司于2012年9月8日发生严重火灾，上海贝岭主要给公司提供型号为RM6203产品的晶圆，2011年度该款产品占全年收入比例约57%，上海贝岭发生火灾后，公司9月底至年底均无生产RM6203型号的产品，公司难以短时间内更换供应商，直到2013年8月完成供应商变更并开始实现量产，该事项对公司2012年度销售量产生了严重影响，导致2012年度销售收入大幅减少。

(3) 公司2012年度开发的新产品市场推广工作效果才刚开始释放，也对2012年度销售收入的减少有一定的影响。

(二) 产品主要消费群体及报告期前五名客户情况

1、产品主要消费群体

公司的产品为应用于 LED 照明、网络通信、智能手机、平板电脑及电视机顶盒、计算机及计算机接口设备等多种电子产品的高转换效率、高可靠性、绿色节能电源管理芯片。其中，LED 照明领域主要应用于 LED 球泡灯、灯管、吸顶灯、射灯及路灯的驱动；消费类电子领域主要应用于计算机、网络通讯、机顶盒、平板电脑、智能手机等充电器或电源适配器。

2、前五名客户情况

2013 年 1-6 月前五名客户情况表

序号	客户名称	销售收入（元）	占公司当期销售收入百分比（%）
1	深圳市泰科达科技有限公司	2,989,329.37	23.03
2	深圳市润格莱电子有限公司	1,263,938.22	9.74

3	深圳康佳信息网络有限公司	1,238,560.83	9.54
4	深圳市文佳晟电子有限公司	1,168,162.00	9.00
5	威海金丰电子有限公司	813,110.50	6.26
合计		7,473,100.92	57.58

2012年度前五名客户情况表

序号	客户名称	销售收入(元)	占公司当期销售收入百分比(%)
1	深圳市冠辰科技有限公司	3,059,643.00	12.95
2	深圳市泰科达科技有限公司	2,424,926.35	10.26
3	深圳市志创诚芯科技有限公司	2,263,800.00	9.58
4	深圳市文佳晟电子有限公司	1,129,920.00	4.78
5	深圳市海霞鑫电子有限公司	1,128,600.00	4.78
合计		10,006,889.35	42.34

2011年度前五名客户情况表

序号	客户名称	销售收入(元)	占公司当期销售收入百分比(%)
1	深圳市泰科达科技有限公司	8,506,889.21	20.24
2	深圳市诺比特电子科技有限公司	4,140,751.68	9.85
3	深圳市海霞鑫电子有限公司	3,686,249.45	8.77
4	沛伦科技(深圳)有限公司	3,128,665.71	7.44
5	深圳市飞泰科技有限公司	2,153,800.40	5.12
合计		21,616,356.45	51.42

(三) 产品原材料情况及报告期前五名供应商情况

1、主要产品原材料、能源及供应情况

公司产品的的主要原材料为晶圆，从晶圆的供应状况看，数模混合工艺平台

基本集中在亚洲，国内也有多家满足公司技术要求的委托加工工艺平台。其中，汉磊科技股份有限公司于 1985 年设立于台湾新竹科学园区，是国内第一家硅磊芯片(Epitaxial Process)制造厂，目前是日本以外亚洲区最大供货商；上海贝岭（600171.SH）创建于 1988 年 9 月，1998 年 9 月成为中国微电子行业第一家上市公司，目前为国内 IC 产品主要供应商之一；华天科技（002185.SZ）成立于 2003 年 12 月，2007 年 11 月上市，为我国最具成长性封装测试企业；华润赛美科微电子（深圳）有限公司为客户提供各种集成电路中测、封装、成测的一体化服务。上述企业均已与公司建立稳定合作关系，同时由于国内晶圆生产企业、封装测试企业数量较多、大小规模各具。从供应商的选择方面，公司不存在对某一供应商的重大依赖；从供应商的更换方面，更换委托加工平台后，公司产品需要重新经过各种检测，这一过程需要一段时间。公司与几家供应商建立较为稳定的合作关系，并根据产能、封装形式、价格、交期等综合考虑选择具体供应商。

2、主要原材料、能源占成本比重

公司属于集成电路行业无生产线设计企业，所有量产产品均采取委托加工方式生产，公司产品的成本主要包括原材料成本和委托加工费用，产品的能耗（水电）占其成本的比重极低。

3、前五名供应商情况

2013 年 1-6 月前五名供应商情况表

序号	供应商名称	采购金额 (元)	占公司当期 采购总额百 分比 (%)
1	西安艾铂电子科技有限公司（华天科技代理商）	2,924,359.89	23.72
2	无锡颐鼎科技公司	2,383,443.42	19.33
3	西安乐晟贸易有限公司（汉磊科技代理进口商）	2,005,464.90	16.26
4	深圳中电投资股份有限公司（汉磊科技代理进口商）	1,358,457.50	11.02
5	深圳方正微电子有限公司	767,481.68	6.22
	合计	9,439,207.39	76.55

2012 年度前五名供应商情况表

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司当期采购总额百分比（%）
1	西安艾铂电子科技有限公司（华天科技代理商）	7,501,516.17	36.40
2	无锡颐鼎科技公司	5,059,185.61	24.55
3	上海贝岭微电子制造有限公司	2,631,074.96	12.77
4	西安乐晟贸易有限公司（汉磊科技代理进口商）	1,348,515.67	6.54
5	深圳方正微电子有限公司	1,203,158.00	5.84
合计		17,743,450.41	86.10

2011 年度前五名供应商情况表

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司当期采购总额百分比（%）
1	西安艾铂电子科技有限公司（华天科技代理商）	11,424,616.08	27.36
2	无锡颐鼎科技公司	8,457,006.98	20.25
3	昱品国际贸易（上海）公司（台湾旺宏代理进口商）	6,253,741.43	14.98
4	上海贝岭微电子制造有限公司	3,929,482.00	9.41
5	西安后羿半导体科技有限公司（华天科技代理商）	3,342,302.48	8.00
合计		33,407,148.97	80.01

（四）重大合同及履行情况

1、报告期内对公司持续经营有重大影响的合同如下：

公司无自有土地使用权和房屋所有权，截至本说明书签署日，公司租赁房屋及建筑物的情况如下：

序号	出租方	坐落位置	面积 m ²	租金（元 /月）	租赁期限	用途
1	西安黄河新时	西安市高新区高	790	35,550	2013年8月1日至	办公、

	代电讯有限责 任公司	新三路九号信息 港大厦 1 层 105 室			2014 年 7 月 31 日	研发
2	深圳恒丰房地 产有限公司	深圳市宝安区西 乡街道宝源路财 富港大厦 D 座 1701A	156.97	11,459	2013 年 5 月 27 日至 2018 年 5 月 26 日	深圳 办事 处

注：公司原租赁西安黄河新时代电讯有限责任公司拥有产权的西安市高新三路九号信息港大厦 3A 层 3A02 室进行办公、研发，因业务发展和员工人数增加，使用面积不足，故与出租方提前终止该场所租赁合同，2013 年 9 月 3 日将办公、研发处所迁移至西安市高新区高新三路九号信息港大厦 105 室。公司租赁的房产均遵循价值规律和市场经济原则，参考当地同类房产的租赁市场价格，与出租方平等协商确定，并根据市场情况进行调节。

2、报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如下：

合同类型	序号	订单日期	订货方/供货方	订单编号	订单金额（元）	已执行比例（%）
销售合同	1	2011-10-8	深圳市泰科达科技有限公司	TKD-20111008001	4,290,000.00	100.00
	2	2011-5-30	深圳市泰科达科技有限公司	TKD-20110615001	345,000.00	100.00
	3	2011-4-28	深圳市泰科达科技有限公司	TKD-20110428001	345,000.00	100.00
	4	2011-8-25	深圳市诺比特电子科技有限公司	CD-000-2011-08-0067	299,200.22	100.00
	5	2011-3-22	深圳市诺比特电子科技有限公司	CD-000-2011-03-0004	340,000.00	100.00
	6	2011-1-15	深圳市诺比特电子科技有限公司	CD-000-2011-01-0006	408,000.00	100.00
	7	2011-2-11	深圳市胜邦电子有限公司	P0201102011	350,000.00	100.00
	8	2011-5-19	深圳市胜邦电子有限公司	P0201105019	350,000.00	100.00

	9	2011-6-28	深圳市胜邦电子有限公司	P0201106028	350,000.00	100.00
	10	2011-6-29	深圳市海霞鑫电子有限公司	HH20110629038	345,000.00	100.00
	11	2011-10-8	沛伦科技(深圳)有限公司	PL-20111008001	4,110,000.00	76.00
	12	2011-3-15	深圳市飞泰科技有限公司	FPOSZT03151100038	280,000.00	100.00
	13	2011-10-8	深圳市冠辰科技有限公司	CG-20111008-001	1,460,000.00	100.00
	14	2011-10-8	深圳市领芯源电子有限公司	LXY-20111008001	1,376,000.00	100.00
	15	2012-3-10	深圳市志创诚芯科技有限公司	PO-1203286	350,000.00	100.00
	16	2013-3-5	深圳市艾森风驰科技有限公司	ASK20120305F	325,000.00	100.00
	17	2012-4-10	深圳市志创诚芯科技有限公司	PO-1204304	650,000.00	100.00
	18	2012-4-18	深圳市汉鼎电子有限公司	KA-201204001	200,000.00	100.00
	19	2012-4-25	深圳市冠辰科技有限公司	CG-20120425-003	1,120,000.00	100.00
	20	2012-3-12	深圳市文佳晟电子有限公司	20120312001	1,129,920.00	100.00
	21	2012-3-26	深圳市泰科达科技有限公司	TKD-20120326001	2,424,926.35	100.00
	22	2012-1-12	常州雷德半导体科技有限公司	LD20120112001	1,110,000.00	100.00
	23	2013-3-1	深圳市泰科达科技有限公司	TKD-20130301001	1,583,213.20	100.00
	24	2013-4-18	深圳市泰科达科技有限公司	TKD-20130418001	1,155,391.50	100.00
	25	2013-2-21	深圳市文佳晟电子有限公司	20120212001	1,168,162.00	100.00
	合计				25,864,813.27	
采购合同	1	2011-1-27	上海凸版光掩模有限公司	REACTOR012711	121,800.00	100.00%
	2	2011-1-4	上海贝岭微电子制造有限公司	PW20110103	479,400.00	100.00%
	3	2011-1-18	上海贝岭微电子制造有限公司	PW20110103	319,600.00	100.00%
	4	2011-3-4	上海贝岭微电子制造有限公司	PW20110301	2,397,000.00	100.00%

5	2011-8-18	昱品国际贸易（上海）公司	PW20110805	636,815.09	100.00%
6	2011-9-1	昱品国际贸易（上海）公司	PW20110806	1,058,016.96	100.00%
7	2011-9-14	昱品国际贸易（上海）公司	PW20110902	1,058,016.96	100.00%
8	2011-9-1	无锡颐鼎科技公司	P020110901	962,500.00	100.00%
9	2011-9-1	无锡颐鼎科技公司	P020110902	504,000.00	100.00%
10	2012-3-6	深圳方正微电子有限公司	P020120301	110,000.00	100.00%
11	2012-11-8	华越微电子有限公司	PW20121102	135,000.00	100.00%
12	2012-5-30	上海贝岭微电子制造有限公司	PW20120502	159,800.00	100.00%
13	2013-2-1	深圳方正微电子有限公司	P020130201	53,244.72	100.00%
14	2013-6-18	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130614	480,000.00	100.00%
15	2013-6-14	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130614	300,000.00	100.00%
16	2013-6-20	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130614	120,000.00	100.00%
17	2013-3-22	无锡华润上华半导体有限公司	P020130308	450,000.00	100.00%
18	2013-4-18	无锡华润上华半导体有限公司	P020130408	450,000.00	100.00%
19	2013-6-14	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130609	300,000.00	100.00%
20	2013-6-18	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130614	480,000.00	100.00%
21	2013-6-20	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130614	120,000.00	100.00%
22	2013-3-12	深圳中电投资股份有限公司	S13ZJ01930019	427,174.80	100.00%
23	2013-7-15	深圳中电投资股份有限公司	S13ZJ01930054	215,149.20	100.00%
合计				11,337,517.73	

截至说明书报出之日，公司未来待履行的重大业务合同如下：

合同类型	序号	订单日期	订货方/供货方	订单编号	订单金额 (元)	已执行比例 (%)
销售合同	1	2013-8-16	深圳市民芯微电子有限公司	MX-CG13-YCW001	390,000.00	0.70
	2	2013-7-15	深圳市泰科达科技有限公司	TKD-20130715001	2,863,290.00	3.60
	3	2013-7-12	威海金丰电子有限公司	JF20130712001	1,840,620.00	21.80
	4	2013-7-26	深圳市文佳晟电子有限公司	20130726001	1,643,740.00	12.35
	合计				6,737,650.00	
采购合同	1	2013-6-1	西安艾铂电子科技有限公司	PP20130601	547,985.12	90.00
	2	2013-7-1	西安艾铂电子科技有限公司	PP20130701	982,256.10	65.00
	3	2013-8-1	西安艾铂电子科技有限公司	PP20130801	1,000,000.00	90.00
	4	2013-6-14	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130609	300,000.00	80.00
	5	2013-6-20	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130614	480,000.00	95.00
	6	2013-8-14	无锡华润华晶微电子有限公司	P020130802	480,000.00	0.00
	7	2013-7-2	深圳市华宇半导体有限公司	PT20130702	280,000.00	90.00
	8	2013-8-1	深圳市华宇半导体有限公司	PT20130801	350,000.00	80.00
	合计				4,420,241.22	

五、公司商业模式

公司作为集成电路行业无生产线的设计企业，采取“自主研发+委托加工”的商业模式。

公司的关键资源要素在于拥有稳定及经验丰富的研发团队，具有较强的自主研发能力，拥有自主知识产权的核心技术。公司研发人员 26 名，约占员工总数的 54%，具有较强的自主研发能力。目前公司拥有 5 项专利技术和 13 项集成电路布图设计证书，还有 6 项已收到受理通知书的专利技术。

在采购环节，由于公司产品的生产采用了代工生产模式，公司采购包括代

工厂商采购和公司直接采购两种方式。晶圆代工环节支付的费用包括原材料和代工费，只有辅助原材料由公司直接采购。

在生产环节，公司采用了代工生产模式，即将集成电路的晶圆生产、芯片制造、封装测试外包，专注于集成电路设计，这符合集成电路垂直分工产业链的特点，也符合国际市场上集成电路设计占整个行业产值比重愈来愈高的趋势发展，同时由于无生产线负担，专注于设计业务，具有灵活性、市场灵敏度高等特点。

在销售环节，公司采取直销和分销相结合的模式，即公司直接销售给终端客户和销售给经销商，经销商再销售给终端客户。这主要源自集成电路行业本身的特性，IC产品由于种类多，可以应用于广泛的终端行业，客户规模大小不一，通过引入经销商，可增强公司的销售能力。

六、公司所处行业的基本情况

公司主营业务为数字模拟混合集成电路产品的设计、开发和销售。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为制造业（C）-通信设备、计算机及其他电子设备制造业（C39）-集成电路制造（C3963）。结合公司具体业务情况，公司所处的细分行业为集成电路行业。

（一）行业概况

1、行业监管体系及产业政策

（1）行业监管体系

行业主管部门主要为国家发展和改革委员会和国家工业和信息化部。其中，国家发展和改革委员会对行业进行宏观调控和指导；国家工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，针对集成电路行业负责制定行业政策、行业规划，组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

公司业务相关的行业协会是中国半导体行业协会，该协会是中国集成电路

行业的行业自律管理机构。协会下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会以及半导体支撑业分会。协会在工信部的指导和管理下，负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

(2) 行业主要法律法规及产业政策

集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。为推动集成电路行业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路行业建立了优良的政策环境，促进集成电路行业快速发展。

主要法律法规及产业政策列表

时间	发文单位	文件名称	相关内容
2000年6月	国务院	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发18号文)	该政策作为集成电路产业发展的核心政策在税收优惠、生产性原材料进口、集成电路技术和成套生产设备进口、设备折旧、知识产权保护等方面对集成电路产业进行大力扶持。
2002年3月	信息产业部、国家税务总局	《集成电路设计企业及产品认定管理办法》(信部联产86号)	为集成电路设计企业享受“国发18号文”制定的审定办法和认定程序。
2005年4月	财政部、信息产业部、发改委	《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》(财建[2005]132号)	明确由国家设立集成电路产业研究与开发专项资金，鼓励集成电路企业加强研究与开发活动。
2005年10月	发改委、信息产业部、税务总局、海关总署	《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法》(发改高技[2005]2136号)	规范国家鼓励的集成电路企业认定工作，进一步贯彻落实国务院有关政策及其配套优惠政策。
2007年1月	发改委、科技部、商务部	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007)》年度	明确将集成电路列入当前优先发展的高技术产业(第十三项)。
2008年3月	财政部、国家税务总局	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》	明确软件、集成电路行业的企业所有税优惠政策

		(财税[2008]1号)	
2009年 4月	国务院	《电子信息产业调整和振兴规划》	提出了“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”的任务目标，并在集成电路产业的产业体系完善、自主创新、产业升级等方面提出优惠措施，加大投入力度及鼓励软件和集成电路产业发展政策的实施力度。
2010年 10月	国务院	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)	提出了“着力发展集成电路、高端软件、高端服务器等核心基础产业”，集成电路产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分，是国家未来重点发展的战略新兴产业。
2011年 1月	国务院	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)	保持了对《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18号)的延续，进一步加大了对集成电路产业的扶持力度，扩大了扶持范围，优惠政策覆盖了产业链各个环节，产业发展环境将进一步得到优化。
2011年 12月	工信部	《集成电路产业“十二五”发展规划》	作为行业2011-2015年发展的指导性文件，明确了未来发展的指导思想、基本原则和发展目标。
2012年 4月	财政部、国家税务总局	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号	进一步落实国发[2011]4号)精神，推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，明确对软件产业和集成电路产业的企业实施所得税优惠政策。
2013年 2月	发改委	《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》第21号令	将集成电路设计列为鼓励类

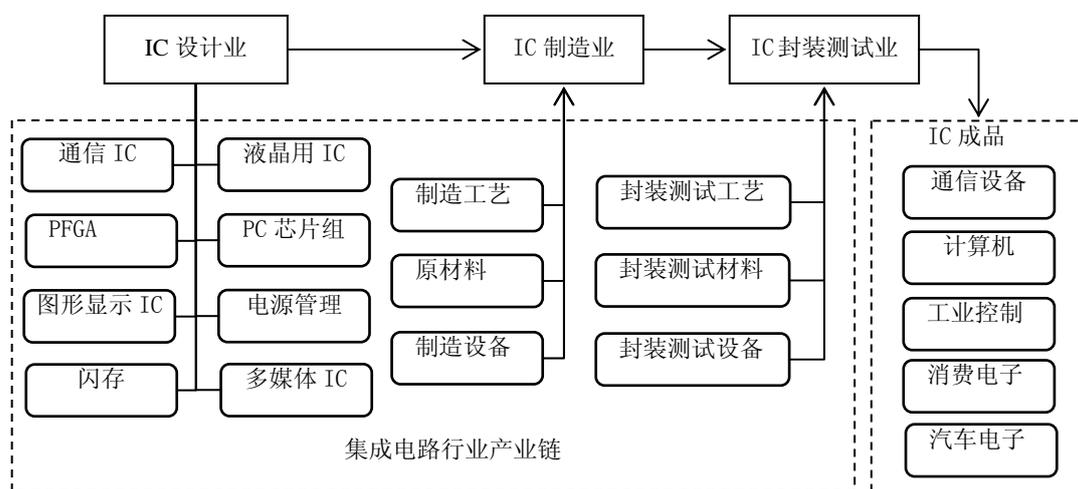
2、行业发展概况及发展趋势

(1) 行业发展概况

自1958年美国德克萨斯仪器公司的基尔比和仙童公司的诺伊斯同时制作出世界第一块集成电路后，在短短几十年内，集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，成为计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。同时集成电路行业的推动作用强，倍增效应大，在推动经济发展上发挥着

重要作用。集成电路行业在整个国民经济中的基础性、战略性地位越来越突出，各国对该行业都极为重视，发达国家和许多新兴工业化国家和地区竞相发展，使得这一行业的竞争非常激烈，激烈的竞争也使得集成电路技术得以不断更新。

集成电路行业的企业根据所处产业链的不同环节，主要可分为 IC 设计、IC 制造和 IC 封装测试三类企业。其中，IC 设计企业主要从事集成电路芯片的设计，通常具有轻资产、高研发投入的特征，是典型的技术和人才密集型企业，位于行业产业链的上游。IC 制造企业，主营业务是根据设计企业下发的订单，进行集成电路芯片的生产，处于产业链中游。而产业链下游，则主要由 IC 封装测试类企业构成，经营领域在于将集成电路晶圆切割分片，并在封装完成后进行性能测试。集成电路行业产业链的基本结构如下图所示。



(2) 行业发展趋势

在集成电路技术发展方面，集成电路行业追求更低功耗、更高集成度、更小体积依然是技术竞争的焦点，SoC 设计技术成为主导；芯片集成度不断提高，仍将沿摩尔定律继续前进。目前国际上 32 纳米工艺已实现量产，2015 年将导入 18 纳米工艺。集成电路产品功能多样化趋势明显，在追求更窄线宽的同时，利用各种成熟和特色制造工艺，采用系统级封装（SiP）、堆叠封装等先进封装技术，实现集成了数字和非数字的更多功能。此外，集成电路技术正孕育新的重大突破，新材料、新结构、新工艺将突破摩尔定律的物理极限，支持微电子技术持续向前发展。

在集成电路市场规模方面，战略性新兴产业的崛起将为行业发展注入新动

力。当前以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动集成电路产业发展的新动力，多技术、多应用的融合催生新的集成电路产品出现。过去五年我国集成电路市场规模年均增速 14%，预计到 2015 年，国内集成电路市场规模将超过 1 万亿元。广阔、多层次的大市场为本土集成电路企业提供了发展空间。全球产业分工细化的趋势，也为后进国家进入全球细分市场带来了机遇。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1) 有利因素

① 产业政策环境持续向好

公司所处集成电路行业为国家重点鼓励的行业，国家制定并实施了一系列的优惠扶持政策。2000 年，国务院颁布了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》和《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，对集成电路行业在投融资、税收、产业技术、出口、人才培养、采购以及知识产权保护 and 境外加工等方面都给予了大力支持。2001 年，国务院制定了《集成电路布图设计保护条例》，该条例的实施对我国集成电路设计领域的知识产权保护起到重要作用，并促进我国集成电路行业的技术创新和自主知识产权的开发。2002 年，信息产业部、国家税务总局颁布了《集成电路设计企业及产品认定管理办法》，通过认证的企业将享受与软件企业相同的优惠政策。2011 年，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）保持了对《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18 号）的延续，进一步加大了对集成电路产业的扶持力度，扩大了扶持范围，优惠政策覆盖了产业链各个环节，产业发展环境将进一步得到优化。这些政策将有力地推动我国集成电路产业的健康稳定发展。

② 国内终端市场需求增长迅速

公司研发的电源管理器芯片不是最终的消费产品，而是现代电子整机产品的部件。公司的产品主要应用于消费类电子和 LED 照明驱动等领域。随着终端

市场的激烈竞争不断地开发出新的应用，带动了处在上游的集成电路设计、特别是公司所处的电源管理芯片行业的拓宽及发展。

③ 行业技术水平日益提高

为了适应终端产品功能的不断更新和性能要求的不断提高，新的技术不断涌现。位于上游的设计公司通过加大技术投入，不断提高产品的技术含量，开发新型产品，从而可以取得较高的利润率水平，获得优势地位；同时，技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，保障行业的健康发展。

④ 国际生产基地向中国集中

近年来，手机、笔记本电脑、数码相机和其他电子信息产品的生产基地都大规模向中国转移，中国已经成为世界电子信息产品的生产基地。我国在初级劳动力、技术研发人才、土地、资本等生产要素成本的优势依然存在，越来越多的境外半导体公司扩大在华生产规模。这些因素，带动了行业的快速增长与竞争。作为上游的设计公司，在委托加工工艺平台的供应商有更多可选择空间，从不断提高的先进工艺技术中提高了产品性能。

(2) 不利因素

① 国际市场的冲击

从 20 世纪 90 年代初跨国公司在国内创办独资或合资企业，以其先进的技术、雄厚的资金实力以及灵活的经营方式，在国内市场竞争中处于较为有利的地位，占有较大的市场份额。

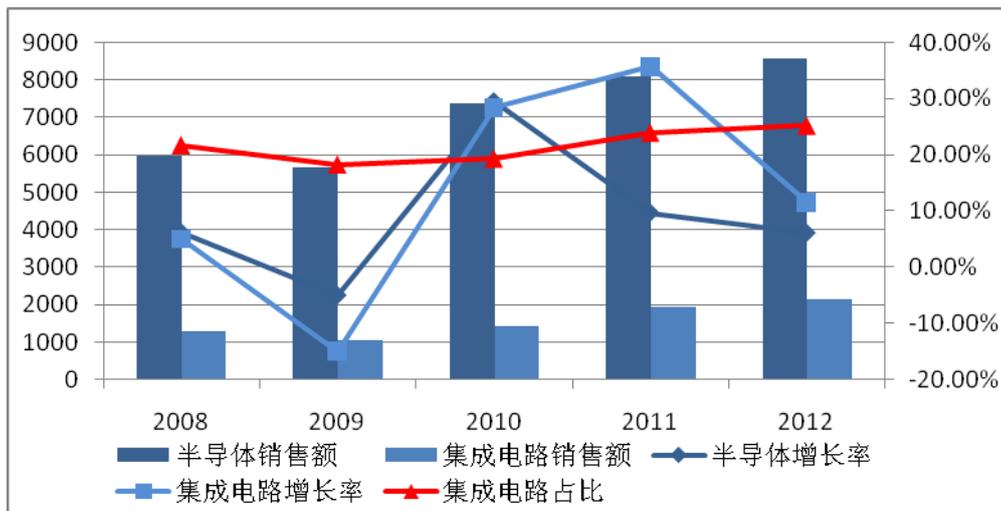
② 国内技术积累较弱

在中国，包括电源芯片在内的 IC 设计产业经过数年的积累，虽然很多公司在技术、资金、人才等方面都有了一定的积累，但与跨国 IC 设计企业相比，在技术、人才、资金等方面都相对薄弱。

(二) 市场规模

根据美国半导体产业协会（SIA）数据，2010 年、2011 年和 2012 年全球半

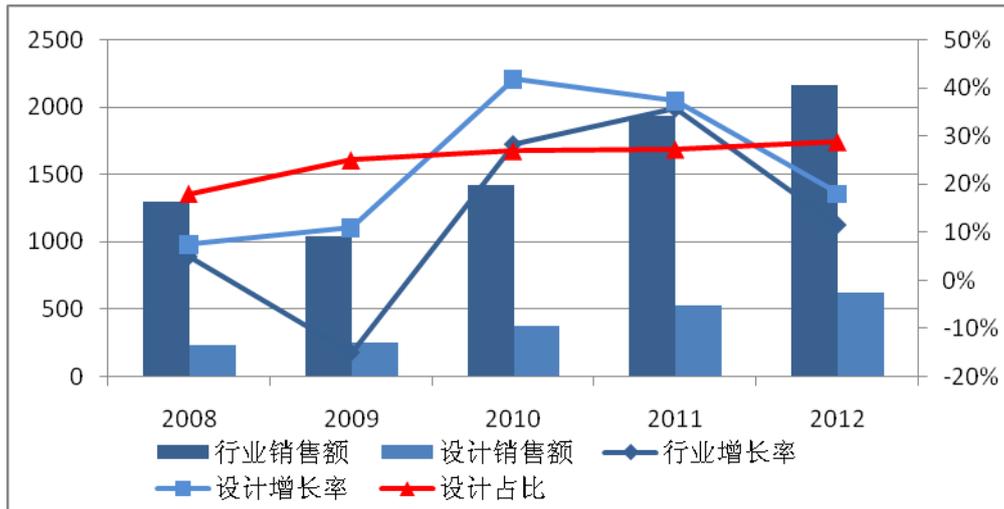
导体市场的营业收入分别为 2983 亿美元、2955 亿美元和 2916 亿美元。2012 年由于全球经济的整体低迷，营业收入相对有所下降，但近三年行业的营业收入仍然保持了一个相对稳定的水平。作为半导体产业主体行业集成电路，从 2008 年至 2012 年，我国集成电路的销售规模由 1300 亿元增长至 2158.9 亿元，除 2009 年受金融危机影响导致销售额出现较大波动外，其余四年均保持了较快增长，增速同样领先与全球市场。2008 年至 2012 年中国半导体市场及集成电路市场销售规模及增长率如下图所示。



2008 年至 2012 年中国半导体与集成电路市场销售规模及增长率

数据来源：中国半导体行业协会

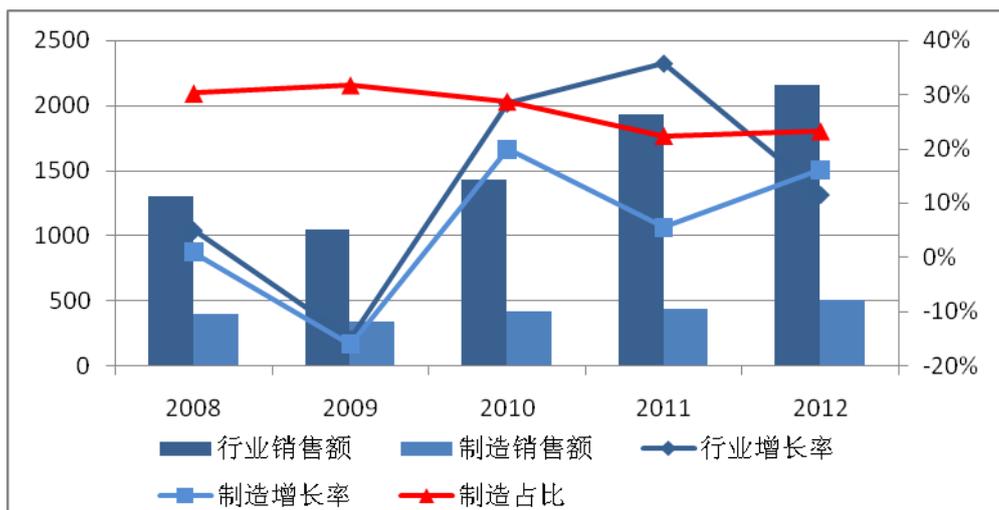
在集成电路设计方面，凭借轻资产、高技术和重人才的特征，国内集成电路设计业的发展极为迅速。自 1986 年北京成立了国内第一家专业设计公司（现中国华大 IC 设计公司）至今，各类 IC 设计企业大量涌现。目前以各种形态存在的设计公司、设计中心、设计室以及具备设计能力的科研院所等 IC 设计单位已超过 500 家，设计行业从业人员超过 5 万人。国内 IC 设计的年设计能力目前已超过 1000 种，产品设计的门类已经涉及计算机与外设、网络通信、消费电子以及工业控制等各个整机门类和信息化工程的许多方面。IC 设计业在行业整体份额中的比重不断增大，并且已经开始成为带动国内集成电路产业整体发展的龙头。



最近5年（2008年-2012年）IC设计业发展概况

数据来源：中国半导体行业协会

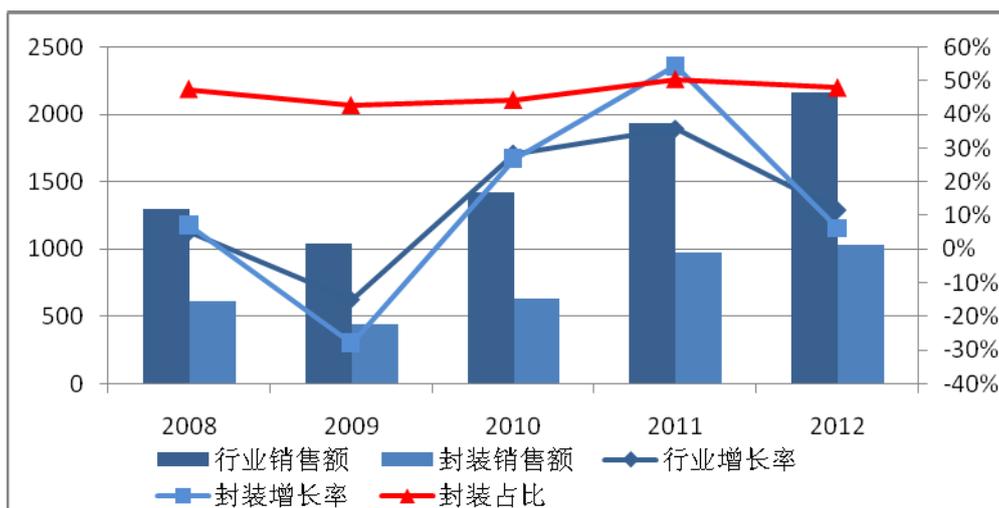
在集成电路制造方面，我国的起步虽然较晚，但是由于其资本密集型特征相对明显，部分芯片制造设备可以通过引进快速形成产业化，而不像 IC 设计必须强调于对设计人才的稳步培养，因此，行业整体发展较快。自 20 世纪 90 年代 908 工程（无锡华晶项目）和 909 工程（上海华虹 NEC 项目）的建成，分别使我国拥有了第一条 6 英寸和第一条 8 英寸芯片生产线之后，经过十余年的发展，目前，国内已经存在超过 50 家的集成电路芯片制造企业，同时拥有超过 50 条的各类集成电路芯片生产线，2012 年完成 823.1 亿块集成电路芯片的生产，较去年增长 14.4%。但从行业整体构成看，制造业所占的比重呈逐年下降的趋势，年增长率也逐渐放缓，应该与其资本投入大、知识和人力成本相对较小的特点相关。



最近5年（2008年-2012年）IC制造业发展概况

数据来源：中国半导体行业协会

相对集成电路设计和制造而言，封装测试行业具有投入资金较小，建设快的优势，行业劳动密集型的特点较为突出。由于前期基础较为薄弱的原因，我国封装测试行业的发展速度很快，但是近年来，平均增速有所放缓，且受宏观环境影响而容易出现较大幅度的波动，劳动密集型行业的特征开始逐步显现。另一方面，行业在整体结构中的比重长期保持不变或者略有下降，表明其并非未来推动集成电路行业整体发展的主要力量。



最近5年（2008年-2012年）IC封装业发展概况

数据来源：中国半导体行业协会

（三）基本风险特征

1、行业竞争加剧，研发压力较大。

国内 IC 设计行业大多规模较小，大量小企业多满足于低端产品的市场开发，创新意识不足，尚未能形成重大的研发核心力量与成果或者找准自身定位在细分市场深度耕耘，同时由于集成电路技术处于不断升级中，因此行业内竞争较为激烈，中小企业研发压力较大。在新产品投入市场前需要较长的研发周期及大量的研发经费，即使研发成功也同样需要面临研发新品未能适应市场需求的风险。

2、国内整体技术落后，高端人才缺乏。

IC 设计行业作为知识密集型行业，对比发达国家和地区，国内有经验的 IC 设计人才相对稀缺，这是造成国内 IC 设计业整体技术基础较弱、水平较低的主要原因，尽管近年来我国 IC 设计行业人员培训力度逐步加大，随着国内技术发展、产业升级，专业设计人员的数量也逐年上升，但人才匮乏的情况依然普遍存在，现已成为当前制约行业发展的主要瓶颈。

3、国内 IC 设计企业普遍采用代工生产，存在委托加工风险。

集成电路行业具有垂直分工的特点，国内 IC 设计企业大部分采取委托加工经营模式，即仅从事 IC 产品的设计、销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。无生产线经营模式具有轻便灵活的特点，没有沉重的生产线运营负担，也无需负担芯片生产线昂贵的维护成本，可以专注于技术创新，通过开发业界领先的技术，依靠晶圆代工厂将技术转化为芯片产品，可以专注于自己的核心业务，充分发挥核心竞争力。但随之而来的风险是晶圆生产、芯片封测需要依赖上游企业，在产能、交货期限以及不可抗力因素方面，公司存在一定程度的委托加工风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

当前全球集成电路行业竞争格局进入重大调整期，主要国家/地区都把加快发展集成电路产业作为抢占新兴产业的战略制高点，投入了大量的创新要素和

资源。同时，随着集成电路新技术革命的持续推进，高性能 IC 集成度和性价比在不断提高，功能愈发强大，工艺节点或特色工艺也在不停攀升，制造和封装技术进步带来投资额度呈几何级数的急剧翻升，由此造成集成电路行业的投资门槛逐渐高耸和行业集中度的开始增加。从产业链结构看，在资本投入密集度较高的集成电路制造和封装测试部分，Intel（美国英特尔）、Samsung（韩国三星）、TI（美国德州仪器）、ST（欧盟意法半导体）和台积电等大型企业已经占据了市场的绝大部分份额，寡头垄断的趋势已经初露端倪。在知识和人才投入更为重要的 IC 设计业，由于对资本投入的依赖性相对较小，目前还存在着中小体量 IC 设计企业的生存空间，竞争对手数量仍相对较多。

2. 行业壁垒

公司所属的集成电路设计行业整体属于技术密集型及资本密集型相结合的行业，研发能力带来的新产品持续开发能力是一个 IC 企业的核心竞争力，因此存在着一定的进入壁垒，具体如下：

（1）技术壁垒

电源管理芯片通常作为下游终端产品的嵌入式组件而存在，一方面需要具有高稳定性、高集成性，本身对电源管理芯片的性能已经提出了较高的要求；另一方面，电源管理芯片应用领域越来越广，如何不断地进行研发投入，以生产出能适应各种新产业、新产品的功能需求的芯片产品，持续的技术研发积累对企业发展较为重要，这也成为行业内潜在进入者进入 IC 设计行业的一大主要障碍。

（2）资金壁垒

由于集成电路行业前期投入研发周期较长，研发投入较大，因此对公司的资本实力有一定要求。同时，由于终端产品更新换代较快，IC 设计企业通常需要能够进行持续的研发投入，研发本身具有一定的风险，保有较为雄厚的资金规模才能够有利于企业抵御相关风险。

（3）客户关系壁垒

不同公司的电源管理芯片通常在嵌入终端产品中需要运用专门的开发工具

进行二次开发，当一家终端厂商选择了一个集成电路供应商后，对集成电路的相关指令集及开发工具的熟悉需要一定的时间，这造成了客户具有一定的产品黏性。更进一步，对于集成电路的主要下游应用行业，如电子消费品领域、LED照明驱动领域，由于对于产品性能稳定性要求较高，所以在选择电源管理芯片公司时，通常经过一定时间的检测或测试，因此更换电源管理芯片供应商亦需要成本投入。较高的客户粘性为后进入者造成了另一大障碍。

(4) 人才壁垒

作为技术密集型行业，高素质的研发队伍对于公司的生存发展至关重要，通常一个合格的 IC 设计人才既要熟悉芯片设计制造，又要熟悉电源管理芯片下游行业特性及对产品功能的特殊需求等，因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可。由于我国核心技术及高端芯片技术的整体水平仍然落后于欧美及日本市场，培养或招募一支高素质的团队对于行业潜在进入者将会构成一定阻碍。

3、公司竞争地位

由于电源管理芯片应用很广，用量巨大，参与的公司很多，造成市场很分散，所以公司在整个市场中所占市场份额较低。但是，公司最近实现量产的新产品具有一定的市场先进性，所占市场份额相对较高。例如，公司针对小于四十瓦功率输出要求的，主要应用于智能手机、平板电脑、网络路由器、充电器以及机顶盒和平板电视等适配器、拥有自由知识产权的高转换效率、极低功耗的系列产品，属于国内领先水平，与欧美大公司产品相比具有更高性价比。公司在 LED 照明驱动芯片方面一直处于行业领先地位，沉淀了多种专利技术。

4、公司竞争优势与劣势

(1) 公司竞争优势

①技术优势。公司具备 Biplor、CMOS、BICMOS、BCD 工艺平台的积累，并在固定工艺平台上已开发验证了多种模拟单元、功能块、工具库、专有设计方法；公司拥有自主知识产权“一种具有渐进式电流过载与饱和防止功能的开关电源”应用在 AC/DC 负边反馈产品上，该类产品性价比较高。

②研发优势。公司已经组建了一支具有较高水平的数模电源管理 IC 设计专业研究团队。目前公司研发人员 26 名，约占公司员工总数的 54%，研发人员都在集成电路领域从业时间较长，积累了丰富的电源管理芯片设计经验。公司能够为客户提供性价比高的电源管理芯片和售后服务。

③综合成本优势。公司基于自主核心技术，在保持芯片性能的前提下，采用自主专利电路技术，特别工艺应用，使芯片面积大大减少；国内研发人员人均工资水平比国外公司低，使公司研发成本较国外同类公司减少 50% 左右；公司通过对研发人员技能的提高，大幅度改善设计效率，缩短研发周期，加快芯片投放市场的时间和资金回流周期。公司制定了严格的成本控制制度，尽量降低公司产品成本，使公司产品具有较高的性价比，在市场竞争中取得综合成本优势。

④市场优势。公司已经发展为一个高品质、低成本竞争力的电源管理集成电路供应商，并获得国内大型电子制造商的认可。公司的集成电路被五大液晶电视制造商之一创维以及由美国制造商出售的路由器产品广泛应用，公司产品的终端客户遍布多个国家和地区。

（2）公司竞争劣势

公司具有开发多种高性能低功耗的电源管理芯片的技术实力，但是，公司成立时间较短，技术积累有限，而且目前融资渠道有限，限制了公司对新业务、新产品的投入能力，影响了开发新产品的进度。

公司作为 IC 设计企业，属于典型的轻资产企业，无法通过固定资产抵押等途径获得银行贷款，公司发展受到融资渠道限制。随着融资问题的解决，公司的技术潜力将得到发挥，新产品的开发进度和投放市场的能力将大幅度增强，公司的销售收入的市场占有率以及盈利水平将会得到相应的提高。

第三章 公司治理

一、公司最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司成立之初，因股东人数少、规模小，没有设立董事会和监事会，仅设立了一名执行董事和一名监事。后因股东人数增加成立了董事会，但仍未设监事会，公司治理不尽完善。

2011年6月股份公司成立后，本公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会和监事会，建立了“三会”治理结构。为进一步建立健全本公司基本法人治理机制，同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定。上述议事规则对“三会”成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等作了进一步的细化规定。

从2011年1月1日始至本说明书签署日，本公司共召开15次股东（大）会、16次董事会及5次监事会。公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

有限公司成立之初，公司治理不尽完善。2011年6月30日，有限公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理机制，制定了较为完善的新《公司章程》，对公司经营中的重大问题都做了较为详细的规定。公司创立大会依法选举产生了董事会、监事会，聘任了董事会秘书和总经理，建立了完备的三会体系，制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》等规则；对公司运营中的关联交易等事项制定了《关联交易决策制度》。为进一步完善公司治理，2013年6月28日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大事项处置权限管理办法》的议案，这些制度的制定健全了

本公司的治理机制，提高了本公司运营的效率 and 效果，增强了本公司的持续经营能力。

另外，本公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括财务管理制度、销售管理制度、采购管理制度等。

公司重要决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供担保的情况。

但由于股份公司成立时间较短，虽建立了完善的公司治理制度，但实际运作中仍存在一些制度执行不彻底、不完全规范的情形。股份公司将在以后的运营管理中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，严格执行已建立的相关制度，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。同时，切实发挥监事会监督职能，规范公司治理。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况

截至本说明书签署日，公司及控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为，未受到工商、海关、环保等国家机关的处罚。

四、公司独立运营情况

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

五、公司同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业同业竞争情况

公司主营业务为数字模拟混合集成电路产品的设计、开发和销售。报告期内公司控股股东、实际控制人余远强还持有北京行健势坤投资咨询有限公司

50%的股权。该公司成立于2008年11月4日，注册资本100万元，主营业务为投资咨询、管理咨询，与本公司不存在同业竞争。随着本公司业务的日益发展，余远强对北京行健势坤投资咨询有限公司的经营管理介入减少，近年该公司经营处于实际停止状态。因此，全体股东决定将其注销。2013年7月18日，北京行健势坤投资咨询有限公司向北京市工商行政管理局海淀分局提出注销申请，已取得该局的注销申请备案通知书，现清算组正进行清算工作。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：

（1）将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；

（2）将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；

（3）或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；

（4）或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

（5）或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

六、公司近两年一期内资金被控股股东、实际控制人占用情况

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。

七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

（一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策的建立情况

有限公司时期，公司未制定对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等

方面的管理制度。《公司章程》条款相对简单，亦未针对重要事项制定相关制度。

股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，重新制定了《公司章程》，对经营管理中的重大事项作出了明确规定，并制定了《关联交易决策制度》和《重大事项处置权限管理制度》等制度性文件。在上述管理办法中规定了具体事项的审批权限及程序，这些规定符合公司治理的规范要求，能保障公司及中小股东的利益。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

1、对外担保、委托理财

报告期内，公司无对外担保、委托理财事项。

2、重大投资

报告期内，公司不存在重大投资事项。

3、关联交易

报告期内发生的关联交易主要是公司向股东个人借款和控股股东、实际控制人及其近亲属为本公司从银行借款提供担保，详情如下：

（1）股东个人向有限公司提供借款

2011年3月26日，有限公司与股东陈楷华签订《借款合同》，陈楷华向有限公司提供75万元借款，期限为2011年3月26日至2012年4月15日，年利率为15.00%。该笔借款已按期偿还。

本次借款未经有限董事会或股东会审议通过，有限公司章程亦未对关联交易作出规定；本次借款利率没有高于公司向其他非本公司股东个人借款利率，未损害本公司利益。

（2）控股股东及其近亲属为公司从莲湖农信社借款提供保证担保

2011年8月24日，西安市莲湖区农村信用合作联社科技路信用社（以下简称“莲湖农信社”）与本公司签订《流动资金借款合同》，约定：莲湖农信社向本公司提供300万流动资金借款，月利率为6.56%，借款期限自2011年8

月 24 日至 2012 年 8 月 23 日。同日，莲湖农信社与余远强、杜明明（系余远强配偶）签订《保证担保合同》，约定由余远强、杜明明为本公司在莲湖区农信社的 300 万贷款提供保证担保。该笔借款已于 2011 年 8 月 21 日还清。

（3）控股股东及其近亲属为公司从浦发西安分行借款提供抵押、保证担保

2012 年 9 月 27 日，上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发西安分行”）与本公司签订《流动资金借款合同》，合同约定：浦发西安分行向本公司提供 500 万贷款用作公司经营周转使用；利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上涨 25%，按季结息，结息日为每季末月的 20 日；提款日为 2012 年 9 月 27 日；保证人为西安创新技术投资担保有限公司（以下简称“创新担保”）、余远强、杜明明；质押人为创新担保。

同日，浦发西安分行分别与余远强、杜明明签订《最高额保证合同》，二人为本公司向浦发西安分行该笔借款提供无限连带担保责任。

2012 年 9 月 26 日，余远强与创新担保签订《反担保（房产抵押）合同》，约定由余远强以其持有的上海市长宁区淮海西路 288 弄 1 号 403 室为创新担保提供反担保。

上述（2）、（3）项关联交易系公司股东余远强及其配偶杜明明为本公司获得银行流动资金贷款而产生的关联交易，符合公司利益，不涉及损害公司及公司其他股东利益的情形，亦不属于应当召开股东大会进行决议的情形。

八、公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司创立大会审议通过了新的《公司章程》、《关联交易决策制度》等文件，这些规范性文件具体规定了股东及其关联方与公司发生交易时应遵循的程序、日常管理、后续风险控制、责任追究、监督检查等内容。2013 年 6 月 28 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案，进一步从制度层面防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生。

九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)、公司董事、监事、高级管理人员持股情况

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	余远强	董事长、总经理	700.56	58.38
2	张炜东	董事	102.60	8.55
3	胡晓博	董事、副总经理	90.00	7.50
4	杨波	董事	30.00	2.50
5	杨世红	董事	8.04	0.67
6	陈楷华	监事会主席	8.04	0.67
7	冯晓波	监事	8.04	0.67
8	张江永	职工监事	0.00	0.00
9	陈彬	财务总监、董事会秘书	9.96	0.83
合计			957.24	79.77

(二)、公司董事、监事、高级管理人员的关联关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(三)、公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况

1、董事张炜东对外投资企业基本情况

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围
毓德(上海)实业发展有限公司	100.00	50.00	日用百货、装饰材料、五金交电陶瓷制品、家用电器、不锈钢制品、电子产品、照明器材的销售,从事计算机领域内的技术咨询,技术开发,技术服务,技术转让,商务信息咨询、实业投资、投资咨询、企业管理咨询,国内货物运输代理服务,室内装潢设计,从事货物及技术的进出口业务
上海杰得投资管理有限公司	100.00	25.00	投资管理,实业投资,投资咨询、企业管理咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪),企业形象策划,市场营销策划,会务服务,酒店管理,办公用品、工艺礼品的销售
百育成(上海)教育投	500.00	20.00	实业投资,投资管理,企业管理咨询(除经纪),教育信息咨询(不得从事教育培训、中介、家教),

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
资有限公司			会务服务

2、董事杨世红对外投资企业基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
西安菲涅尔电子科技有限公司	100.00	50.00	太阳能光伏发电系统、光电子产品及其配套产品的设计、生产与销售；太阳能光伏发电工程施工和维护；自动化系统设计与施工；办公用品、仪器仪表、工控与配电器材的销售；计算机软硬件、通信器材的开发、销售及设备维修、信息技术咨询与服务等
陕西天盛新材料科技有限公司	500.00	25.00	电子浆料的研发、生产及销售
西安众为通信技术有限公司	100.00	10.00	通信业务施工、维护、优化及技术服务；广告的设计、发布、代理；计算机软硬件开发、技术服务及销售代理；计算机系统集成、企业信息化技术咨询；通信产品、机电设备（除特种设备）的开发、施工、技术咨询与服务；公共安全防范工程设计及施工；电子产品、电力设备、公共安全防范设备、仪器仪表、矿产品（除专控）、五金交电的销售；钢结构工程施工

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情形。上述公司的经营范围、主营业务等均与本公司不同。

因此，公司董事、监事和高级管理人员未直接或通过其他任何方式间接从事与本公司业务构成同业竞争的经营活动。

(四)、公司董事、监事、高级管理人员在外任职情况

姓名	本公司所任职务	兼职单位名称	兼职单位所任职务	兼职单位与本公司的关系
----	---------	--------	----------	-------------

姓名	本公司所任职务	兼职单位名称	兼职单位所任职务	兼职单位与 本公司的关系
余远强	董事长、总经理	北京行健势坤投资咨询有限公司	执行董事	同一控制人
张炜东	董事	上海阳帆国际货运代理有限公司	总经理	关联方关系
杨波	董事	西安科技大学	教师	无关系
冯晓波	监事	艾默生网络能源西安研发中心	副总监	无关系

(五)、公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事张炜东、监事陈楷华、冯晓波因不是公司在册员工，未与公司签订劳动合同外，其他董事、监事、高级管理人员均与公司签订劳动合同。

公司董事、监事、高级管理人员已对下列情形做出了书面声明并签字承诺：

(1) 近两年无违法违规行为，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

(2) 不存在对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的企业、公司的情形；

(3) 近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的；

(4) 不存在其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

十、公司董事、监事、高级管理人员近两年一期内的变动情况和原因

公司创始人余远强自有限公司成立至今一直担任公司执行董事或董事长、总经理；张炜东自 2008 年 8 月至今任有限公司和股份公司董事；胡晓博自 2008 年 3 月加入有限公司至今任副总经理；陈彬自 2009 年 3 月加入有限公司至今任财务总监，股份公司成立后兼任董事会秘书。上述四人未发生变动。

2011 年 6 月 20 日，股份公司召开创立大会，按照《公司法》的有关董事会、监事会人员任职、构成的规定，选举胡晓博、杨波、赵军亚为股份公司董事，原有限公司董事李葆春、吴丽萍退出董事会。同日，股份公司创立大会增

选陈楷华、冯晓波为股东代表监事，与职工监事张江永共同组成股份公司第一届监事会。2013年5月22日，董事赵军亚因个人原因提请辞去董事职务，股东大会补选杨世红为公司董事，杨世红具有深厚的技术研发能力，增强了公司的研发实力。上述人员的变动主要是为了提高公司的规范运作和运营管理能力，符合法律、行政法规和公司章程的规定，履行了必要的法律程序并办理了相应的工商备案登记手续，合法有效；其变动没有对公司重大决策、生产、经营管理、合法存续和持续稳健经营产生不利影响。

第四章 公司财务

一、最近两年一期财务报表和审计意见

(一) 最近两年一期财务会计报告的审计意见

1、最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年-2013 年 6 月 30 日的财务会计报告业经希格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了希会审字（2013）1528 号标准无保留意见审计报告。

2、合并报表范围

报告期内，公司无纳入合并的子公司。

3、财务报表的编制基础

公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

(二) 最近两年一期经审计的资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及其补充资料和股东权益变动表

以下财务数据无特殊说明，单位均为人民币元。

资产负债表

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产			
流动资产：			
货币资金	1,357,732.42	1,603,731.59	38,721.29
应收票据	150,000.00	435,969.3	-
应收账款	6,083,721.98	4,924,365.24	14,361,145.17
预付款项	1,443,054.62	1,379,753.04	755,134.02
其他应收款	7,060.00	234,210.00	3,869.50
存 货	14,273,150.06	12,371,254.81	14,360,162.38
流动资产合计	23,314,719.08	20,949,283.98	29,519,032.36

项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
非流动资产:			
固定资产	1,402,419.20	837,739.84	862,957.84
无形资产	8,741,599.97	9,625,162.16	4,177,779.99
开发支出	1,475,197.66	-	-
递延所得税资产	24,209.42	2,809.90	831.08
非流动资产合计	11,643,426.25	10,465,711.90	5,041,568.91
资产总计	34,958,145.33	31,414,995.88	34,560,601.27
负债			
流动负债:			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00-
应付账款	4,040,396.65	2,785,646.38	5,543,120.21
预收款项	330,004.60	6,000.00	36,150.00
应付职工薪酬	240,807.13	25,975.48	268,004.34
应交税费	119,546.94	205,252.73	875,757.95
应付利息	9,583.33	19,537.67	-
其他应付款	2,417,500.00	1,100,000.00	6,313,135.73
流动负债合计	12,157,838.65	9,142,412.26	16,036,168.23
非流动负债:			
专项应付款	861,755.81	1,364,013.28	-
非流动负债合计	861,755.81	1,364,013.28	-
负债合计	13,019,594.46	10,506,425.54	16,036,168.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
资本公积	37,206.08	37,206.08	37,206.08
盈余公积	938,035.09	938,035.09	699,621.36
未分配利润	8,963,309.70	7,933,329.17	5,787,605.60
所有者权益合计	21,938,550.87	20,908,570.34	18,524,433.04
负债和所有者权益总计	34,958,145.33	31,414,995.88	34,560,601.27

利润表

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	11,093,177.05	20,200,903.22	35,929,444.31
减：营业成本	7,823,768.84	15,001,370.63	24,778,964.20
营业税金及附加	15,376.60	36,903.10	6,906.08
销售费用	433,515.21	895,879.87	610,386.39
管理费用	1,486,374.62	1,814,569.03	1,767,854.92
财务费用	248,171.89	672,888.69	486,432.10
资产减值损失	1,926.00	154,262.08	41,556.84
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,084,043.89	1,625,029.82	8,237,343.78
加：营业外收入	-	951,000.00	-
减：营业外支出	-	-	2,348.58
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,084,043.89	2,576,029.82	8,234,995.20
减：所得税费用	54,063.36	191,892.52	1,238,781.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,029,980.53	2,384,137.30	6,996,213.58
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.09	0.20	0.58
（二）稀释每股收益	0.09	0.20	0.58

现金流量表

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	8,400,082.99	27,301,023.81	24,120,436.11
收到其他与经营活动有关的现金	227,970.18	3,050,600.00	5,736.52
经营活动现金流入小计	8,628,053.17	30,351,623.81	24,126,172.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,264,291.89	13,993,325.18	31,671,000.72
支付给职工以及为职工支付的现金	408,247.87	1,176,840.10	589,286.44
支付的各项税费	362,772.58	1,458,511.71	398,697.45
支付其他与经营活动有关的现金	60,959.80	1,517,459.37	954,752.41
经营活动现金流出小计	7,096,272.14	18,146,136.36	33,613,737.02
经营活动产生的现金流量净额	1,531,781.03	12,205,487.45	-9,487,564.39
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-	405.00
投资活动现金流入小计	-	-	405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,335,939.40	6,788,083.82	2,393,233.97
支付其他与投资活动有关的现金	502,257.47	-	-
投资活动现金流出小计	2,838,196.87	6,788,083.82	2,393,233.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,838,196.87	-6,788,083.82	-2,392,828.97
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	6000,000.00
取得借款收到的现金	2,350,000.00	5,000,000.00	8,997,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,350,000.00	9,600,000.00	14,997,450.00
偿还债务支付的现金	1,100,000.00	12,808,939.75	4,321,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,583.33	643,453.58	190,285.41
筹资活动现金流出小计	1,289,583.33	13,452,393.33	4,511,285.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,416.67	-3,852,393.33	10,486,164.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-245,999.17	1,565,010.30	-1,394,228.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,603,731.59	38,721.29	1,432,950.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,732.42	1,603,731.59	38,721.29

2013年1-6月股东权益变动表

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、2012年12月31日余额：	12,000,000.00	37,206.08	-	-	938,035.09	7,933,329.17	20,908,570.34
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	12,000,000.00	37,206.08	-	-	938,035.09	7,933,329.17	20,908,570.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	1,029,980.53	1,029,980.53
(一)净利润	-	-	-	-	-	1,029,980.53	1,029,980.53
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	1,029,980.53	1,029,980.53
四、2013年6月30日余额	12,000,000.00	37,206.08	-	-	938,035.09	8,963,309.70	21,938,550.87

2012 年股东权益变动表

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、2011 年 12 月 31 日余额	12,000,000.00	37,206.08	-	-	699,621.36	5,787,605.60	18,524,433.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,000,000.00	37,206.08	-	-	699,621.36	5,787,605.60	18,524,433.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	238,413.73	2,145,723.57	2,384,137.30
(一)净利润	-	-	-	-	-	2,384,137.30	2,384,137.30
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	2,384,137.30	2,384,137.30
(三)利润分配	-	-	-	-	238,413.73	-238,413.73	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	238,413.73	-238,413.73	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
四、2012 年 12 月 31 日余额	12,000,000.00	37,206.08	-	-	938,035.09	7,933,329.17	20,908,570.34

2011 年股东权益变动表

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、2010 年 12 月 31 日余额：	3,336,400.00	-	-	-		295,397.51	3,631,797.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,336,400.00	-	-	-		295,397.51	3,631,797.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	8,663,600.00	37,206.08	-	-	699,621.36	5,492,208.09	14,892,635.53
(一)净利润	-	-	-	-	-	6,996,213.58	6,996,213.58
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	6,996,213.58	6,996,213.58
(三)所有者投入和减少的资本	8,663,600.00	37,206.08	-	-	-	-	8,700,806.08
1、所有者投入资本	8,663,600.00	37,206.08	-	-	-	-	8,700,806.08
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	699,621.36	-1,504,005.49	-804,384.13
1、提取盈余公积	-	-	-	-	699,621.36	-699,621.36	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-804,384.13	-804,384.13
四、2011 年 12 月 31 日余额	12,000,000.00	37,206.08	-	-	699,621.36	5,787,605.60	18,524,433.04

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

本公司采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

人民币为本公司的主要交易货币，本公司以人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（从购买日起 3 个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

（四）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则 17 号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由其产生的汇兑差额，计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有

者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。按照上述方法折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在未分配利润项目后单独列示。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的“未分配利润”金额列示；“未分配利润”按折算后的股东权益变动表中其他个项目的金额计算列示。

外币现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（五）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债），是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等

初始计量时以取得时的公允价值（支付价款中已宣告但尚未发放的现金股利

或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。

初始计量时按取得时公允价值(支付价款中已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项,是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产,是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

初始计量时按取得时公允价值(支付价款中已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积--其他资本公积。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

后续计量按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价

确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已

经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；其它表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

本公司无改变持有意图或能力发生改变的依据，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

(六) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准：

本公司根据现有的经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为人民币 500 万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为单项余额在人民币 50 万元以上的往来单位。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确认标准：账龄超过3年以上的应收款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。

3、其他不重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

其他不重大的应收款项的确认标准：除上述第（1）、（2）种情形以外的其他应收款项单项。

其他不重大的应收款项坏账准备的计提方法：按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄划分为若干组合，结合公司现时情况确定各组合坏账准备的比例。按照各级账龄和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备。计提的比例如下：

账 龄	应收账款坏账准备计提比例%	其他应收款坏账准备计提比
6个月以内	-	-
7至12个月	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准后核销时，冲销提取的坏账准备。

当公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现方式融资时，根据相关合同的约定，债务人到期未清偿该项债务的情况下，如公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；如没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认转让债权形成的损益。

（七）存货

1、存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、存货的计价方法

存货中各类材料均按实际发生的历史成本核算；领用发出时采用加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

(1) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果可变现净值高于成本，则该材料存货按成本计量，如果材料的价格下降导致生产的产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(2) 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值的计算基础。

(3) 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格做为可变现净值的计算基础。如果持有存货的数量高于销售合同订购的数量，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物采用领用时一次摊销法进行摊销。

(八) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率（%）	残值率（%）
房屋及建筑物	20-50年	1.80 - 4.50	10
机器设备	5-10年	9.00-18.00	10
运输工具	5年	18.00	10
通讯、电子电器设备	5年	18.00	10
其他	5年	18.00	10

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（九）借款费用

1、借款费用的确认原则

本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(1) 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：**a** 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；**b** 借款费用已经发生；**c** 为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化，当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定:

(1) 专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在

所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

(2)一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(十) 无形资产的确认和计量

无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

1、无形资产的初始计量

购买无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满

足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

内部自行开发的无形资产，系开发阶段的支出成本，包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。前期调研阶段的研发费用直接计入当期损益。

2、后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁

期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项 目	预计使用寿命
专利权	5 年
软件	5 年
土地使用权	土地证登记使用年限

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4、无形资产减值

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项

无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（十一）开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为研发阶段，研发支出予以资本化。

研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十二）长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

（十三）收入

销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与

所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

（十四）政府补助

1、类型

政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分

配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十五）递延所得税资产

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（a）该项交易不是企业合并；（b）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（a）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（b）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（十六）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

(一) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

(1) 营业收入主要构成分析

最近两年一期营业收入的主要构成及变化趋势表

项 目	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
消费类电子用 AC/DC 转换芯片	9,302,475.58	83.86	17,956,587.71	88.89	23,657,755.07	65.85
LED 照明驱动芯片	1,790,701.47	16.14	2,244,315.51	11.11	12,271,689.24	34.15
合计	11,093,177.05	100.00	20,200,903.22	100.00	35,929,444.31	100.00

公司 2013 年 1-6 月、2012 年度及 2011 年度营业收入分别为 11,093,177.05 元、20,200,903.22 元及 35,929,444.31 元。2012 年度比 2011 年度收入减少 15,728,541.09 元，减幅为 43.78%，主要是公司销售量大幅下降导致，原因分析请参见第四章“公司财务”之第三节中“营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明”之营业收入变动分析部分。

(2) 主营业务收入产品毛利率结构分析

最近两年一期主营业务收入产品毛利率构成表

业务类别	2013 年 1-6 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)	毛利 (元)	毛利率 (%)
消费类电子用 AC/DC 转换芯片合计	2,722,054.42	29.26%	4,425,145.42	24.64%	6,946,730.53	29.36%
LED 照明驱动芯片合计	547,353.79	30.57%	774,387.17	34.50%	4,203,749.58	34.26%
合计	3,269,408.21	29.47%	5,199,532.59	25.74%	11,150,480.11	31.03%

从公司总体的毛利率来看，报告期内变化不大，2012年度略低，主要由于2012年度市场竞争加剧，部分厂家采取降价策略，公司为确保市场份额也适当降低了部分产品价格，导致2012年度毛利率较2011年度及2013年1-6月份毛利率略低。

(3) 营业收入变动分析

公司所属行业为集成电路行业，报告期内，公司主营业务收入均主要为销售电源管理芯片，从行业每年销售淡旺季的周期来看，通常第一季度由于春节影响产销量均极低，第二季度市场逐步开始放量，第三季度和第四季度开始为圣诞、元旦大量电子产品做准备，销售量大幅飙升，占全年销售量的70%左右。2012年度与2011年度相比，销售收入大幅下降，主要原因有以下几个方面：

①公司自2010年起研发LED照明驱动芯片相关产品，并于2011年度实现量产后投入市场，获取了较好的销售收入。但由于LED照明市场作为一个新的正在发展过程中的市场，在市场标准、技术及客户需求方面都存在很多不确定性。公司2011年研发的LED照明驱动芯片相关产品质量和性能标准较高，但由于行业标准尚未统一，客户在选择产品上更多的倾向于质量和性能相对较低且成本较低的产品，因此公司2012年度的LED照明驱动芯片销量降低。

②公司的主要供应商之一上海贝岭微电子制造有限公司于2012年9月8日发生严重火灾，上海贝岭主要给公司提供型号为RM6203产品的晶圆，2011年度该款产品占全年收入比例约57%。上海贝岭发生火灾后，公司8月底至年底均无生产RM6203型号的产品，公司难以短时间内更换供应商，直到2013年8月完成供应商变更并开始实现量产，该事项对公司2012年度销售量产生了严重影响，导致2012年度销售收入大幅减少。

③公司2012年度开发的新产品市场推广工作才刚开始释放，也对2012年度销售收入的减少有一定的影响。

2、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近两年一期营业收入、成本及利润对比表

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度	
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)
营业收入	11,093,177.05	20,200,903.22	-43.78	35,929,444.31	232.44
营业成本	10,009,133.16	18,575,873.40	-39.46	27,692,100.53	207.25
营业利润	1,084,043.89	1,625,029.82	-80.27	8,237,343.78	1851.20
利润总额	1,084,043.89	2,576,029.82	-68.72	8,234,995.20	1049.04
净利润	1,029,980.53	2,384,137.30	-65.92	6,996,213.58	1048.46

从上表可见，公司2013年的经营状况总体呈上升趋势。

(二) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近两年一期费用及结构分析表

项目	2013年1-6月	2012年度		2011年度	
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	增长率(%)
营业收入(元)	11,093,177.05	20,200,903.22	-43.78	35,929,444.31	232.44
销售费用(元)	433,515.21	895,879.87	46.77	610,386.39	58.47
管理费用(元)	1,486,374.62	1,814,569.03	2.64	1,767,854.92	8.47
财务费用(元)	248,171.89	672,888.69	38.33	486,432.10	136.17
销售费用占主营业务收入比重(%)	3.91	4.43	160.59	1.70	-52.30
管理费用占主营业务收入比重(%)	13.40	8.98	82.52	4.92	-67.38
财务费用占主营业务收入比重(%)	2.24	3.33	146.67	1.35	-29.16

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、差旅费、业务宣传费等。公司2012年销售费用895,879.87元，比去年增加46.77%，主要为员工工资类费用支出增加和办公类费用的增加。其中，销售费用中人员工资支出增加较大，其原因为2012年度开发出的新产品需要积极开拓市场，2012年公司增加了销售人员并给原有销售人员提高了工资。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、无形资产摊销、研发费用等，2013年管理费用同比增加63.55%，主要原因为员工工资增加以及无形资产摊销增加所致。

公司2012年财务费用672,888.69元，与上年相比增幅较大，主要原因为公司2012年新增借款（200万元）引起的利息支出的增加。

(三) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近两年一期非经常性损益情况表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
----	-----------	--------	--------

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
营业外收入——政府补助	-	950,600.00	-
——非流动资产处置损益	-	-	-
——其他	-	400.00	-
营业外支出——资产处置损失	-	-	-2,348.58
非经常性损益合计	-	951,000.00	-2,348.58
减：所得税影响数	-	142,650.00	-352.29
非经常性损益净额	-	808,350.00	-1,996.29
非经常性损益占当期净利润的比例%（%）	-	33.91	-0.03

公司仅2012年度存在重要非经常性损益事项，主要为营业外收入951,000.00元，其中：2012年度政府补助系根据本公司与科技部、陕西省科技厅三方签订的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同书》，由西安市财政局拨付的“采用有源PFC技术的新型LED照明驱动芯片”无偿资助640,000.00元；根据西安高新区管委会关于鼓励企业进入代办股份系统挂牌交易暂行办法（西高新发〔2010〕20号），由西安市高新技术开发区科技投资服务中心拨付的一次性经费补贴300,000.00元；根据陕西省专利申请专项资金管理办法（暂行），由西安市高新技术开发区科技投资服务中心拨付的知识产权补贴10,600.00元。

2013年1-6月、2012年度及2011年度非经常性损益金额占公司扣除非经常性损益后的净利润的比重分别为0、33.91%及-0.03%，公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

表 4-6 公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	17%	销售收入
城市维护建设税	7%	流转税
教育费附加	3%	流转税
地方教育费附加	2%	流转税
企业所得税	15%	应纳税所得额

本公司 2009 年 12 月首次被认定为高新技术企业，有效期三年，根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自 2010

年开始享受高新技术企业 15% 所得税优惠税率。2012 年高新技术企业复审通过，有效期三年，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司在高新技术企业有效期内可享受 15% 所得税优惠税率。公司在报告期内 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月适用 15% 的企业所得税税率。

(四) 主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金：	6,712.40	926,638.32	1,596.07
人民币	6,712.40	926,638.32	1,596.07
银行存款：	1,351,020.02	677,093.27	37,125.22
人民币	1,351,020.02	677,093.27	37,125.22
合计	1,357,732.42	1,603,731.59	38,721.29

公司 2012 年 12 月 31 日货币资金余额较 2011 年 12 月 31 日增加 1,565,010.30 元，主要原因为由于 2012 年度新增短期借款 200 万元。

2、应收票据

种类	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	150,000.00	435,969.30	

于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日，公司无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 最近两年的应收账款及坏账准备情况表：

项目	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
0-6 个月	6,047,127.98	97.75	-	4,924,365.24	100.00	-	14,361,145.17	100	-
7-12 个月	38,520.00	2.25	1,926.00	-	-	-	-	-	-
合计	6,085,647.98	100	1,926.00	4,924,365.24	100	-	14,361,145.17	100	-

从应收账款账龄结构来看，公司的应收账款账龄结构较好，出现坏账损失的可能性较小。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	深圳市泰科达科技有限公司	1,998,334.70	32.85	货款	1 年以内
2	威海金丰电子有限公司	813,110.50	13.37	货款	1 年以内
3	深圳市润格莱电子有限公司	684,380.76	11.25	货款	1 年以内
4	深圳市鑫鼎兴电子有限公司	444,080.00	7.30	货款	1 年以内
5	深圳康佳信息网络有限公司	435,761.82	7.16	货款	1 年以内
合计		4,375,667.78	71.92		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	深圳市冠辰科技有限公司	1,298,510.00	26.37	货款	1 年以内
2	深圳市志创诚芯科技有限公司	380,400.00	7.72	货款	1 年以内
3	深圳市华夏通用电子有限公司	350,000.00	7.11	货款	1 年以内
4	深圳康佳信息网络有限公司	340,992.99	6.92	货款	1 年以内
5	深圳市文佳晟电子有限公司	322,425.25	6.55	货款	1 年以内
合计		2,692,328.24	54.67		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	欠款金额 (元)	占应收账款比例 (%)	款项性质	账龄
1	深圳市泰科达科技有限公司	4,810,149.21	33.49	货款	1 年以内
2	威海金丰电子有限公司	2,069,250.69	14.41	货款	1 年以内
3	深圳市海霞鑫电子有限公司	1,429,474.45	9.95	货款	1 至 2 年
4	沛伦科技(深圳)有限公司	1,078,800.00	7.51	货款	1 年以内
5	深圳市冠辰科技有限公司	1,071,600.00	7.46	货款	1 年以内
合计		10,459,274.35	72.83		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及应收其他关联方款项。

4、预付账款

(1) 最近两年一期的预付账款情况分析如下:

项目	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
0-6个月	1,443,054.62	100	-	1,379,753.04	100	-	755,134.02	100	-
7-12个月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,443,054.62	100	-	1,379,753.04	100	-	755,134.02	100	-

(2) 截至2013年6月30日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额	占总金额比例 (%)	款项性质	账龄
1	深圳中电投资股份有限公司	1,231,380.65	85.33	货款	1年以内
2	深圳恒丰房地产有限公司	45,365.00	3.14	房租	1年以内
3	华越微电子有限公司	45,000.04	3.12	货款	1年以内
4	无锡华润上华半导体有限公司	38,283.60	2.65	货款	1年以内
5	深圳市建信装饰工程有限公司	34,830.00	2.41	装修款	1年以内
合计		1,394,859.29	96.66		

(3) 截至2012年12月31日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额	占总金额比例 (%)	款项性质	账龄
1	西安乐晟贸易有限公司	965,320.89	69.96	货款	1年以内
2	昱品国际贸易(上海)公司	349,002.81	25.29	货款	1年以内
3	无锡华润上华半导体有限公司	28,800.00	2.09	货款	1年以内
4	西安黄河新时代电讯有限公司	17,629.34	1.28	房租	1年以内
5	深圳方正微电子有限公司	10,000.00	0.72	货款	1年以内
合计		1,370,753.04	99.35		

(4) 截至2011年12月31日预付账款前五名

序号	单位名称	欠款金额	占总金额比例 (%)	款项性质	账龄
1	西安乐晟贸易有限公司	455,641.69	60.34	货款	1年以内
2	深圳市英捷迅实业发展有限公司	161,056.69	21.33	货款	1年以内
3	西安景程微电子有限公司	60,000.00	7.95	货款	1年以内
4	西安高新区管委会新三板	32,000.00	4.24	律师费	1年以内
5	大连精拓光电有限公司	28,810.00	3.82	货款	1年以内
合计		737,508.38	97.67		

(5) 预付账款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项及预付其他关联方的款项。

5、其他应收款

(1) 最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

项目	2013年6月30日			2012年12月31日			2011年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
0-6个月	4,350.00	31.05	-	231,500.00	95.99	-	2,650.00	28.16	132.50
7-12个月	2,000.00	14.28	100.00	2,000.00	0.83	100.00	2,650.00	-	-
1-2年	900.00	6.42	90.00	900.00	0.37	90.00	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-	6,760.00	71.84	5,408.00
5年以上	6,760.00	48.25	6,760.00	6,760.00	2.81	6,760.00	-	-	-
合计	14,010.00	100	6,950.00	241,160.00	100	6,950.00	9,410.00	100	5,540.50

公司 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额为 241,160.00 元，比 2011 年末余额增加 231,750.00 元，变动较大主要原因为马斐个人借款，此借款已在 2013 年 03 月 14 日归还。公司报告期内其他应收款余额变动合理、真实可靠。公司按照一贯的坏账准备政策计提其他应收款的坏账准备，公司其他应收款不可回收风险较小。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应收款余额前三名的情况

序号	单位名称	金额	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	西安黄河新时代电讯有限公司	10,010.00	71.46	房租押金	1 年以内
2	项行萍	2,000.00	14.27	行政人员备用金	1 年以内
3	吴菁凌	2,000.00	14.27	行政人员备用金	1 年以内
	合计	14,010.00	100		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额前四名的情况

序号	单位名称	金额	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	马斐	198,000.00	82.10	个人借款	1 年以内

序号	单位名称	金额	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
2	孙斌	33,500.00	13.89	个人借款	1年以内
3	西安黄河新时代电讯有限公司	7,660.00	3.18	房租押金	1年以内
4	项行萍	2,000.00	0.83	行政人员备用金	1年以内
合计		241,160.00	100		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前一名情况

序号	单位名称	金额	占总额比例 (%)	款项性质	账龄
1	西安黄河新时代电讯有限公司	9,410.00	100	租房押金	1年以内

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款及应收其他关联方的款项。

6、存货

项目	2013 年 6 月 30 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	256,631.84	-	256,631.84	267,703.93	-	267,703.93	1,097,028.80	-	1,097,028.80
产成品	5,889,562.29	11,782.68	5,877,779.61	4,665,769.65	11,782.68	4,653,986.97	2,472,555.73	-	2,472,555.73
在产品	8,138,738.61	-	8,138,738.61	7,449,563.91	-	7,449,563.91	10,790,577.85	-	10,790,577.85
合计	14,284,932.74	11,782.68	14,273,150.06	12,383,037.49	11,782.68	12,371,254.81	14,360,162.38	-	14,360,162.38

于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日，公司均无用于担保或所有权受到限制的存货。

公司存货由原材料、库存商品及在产品构成，原材料主要包括采购的晶圆，在产品主要是指处于中测、封装、成测等不同加工阶段的半成品。

公司采用 Fabless 模式进行运营，即晶圆生产及封装测试都由代工企业完成，因大部分晶圆采购自台湾，加上进口报关的时间，产品的加工周期通常需要 3-4 个月，公司至少需要保有 3-4 个月的销售库存。

于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日，公司存货余额分别为 14,360,162.38 元、12,371,254.81 元及 14,273,150.06 元。由于代工企业春节放假及行业生产淡季设备检修，通常都有一个月左右的停产时间，因

此 12 月底公司的存货保有量约为下一年度前 4 个半月的计划销售量。公司 2011 年底计划 2012 年实现销售收入 4500 万元，2012 年底计划 2013 年实现销售收入 3500 万元，对应的 2011 年及 2012 年底的存货余额大约分别为 1350 万元及 1050 万元。2013 年 6 月底存货余额为 1458 万元。按照 2013 年实现 3500 万元的销售计划，三季度每月计划实现销售收入 450 万元，6 月底需要保有大约 1400 万元的存货。

2012 年 12 月 31 日结存的 LED 照明相关产品已于 2013 年全部出售，且销售价格高于成本，不存在减值迹象。

7、固定资产及折旧

(1) 于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日固定资产原值、折旧、净值及其变动情况如下：

项目	2012 年 1 月 1 日	本期 增加	本期 减少	2012 年 12 月 31 日	本期 增加	本期 减少	2013 年 6 月 30 日
一、账面原值合计：	1,178,095.56	99,168.51	-	1,277,264.07	631,798.09	-	1,909,062.16
其中：机器设备	1,084,663.83	40,750.41	-	1,125,414.24	46,867.67	-	1,172,281.91
办公设备	24,104.73	38,911.70	-	63,016.43	32,140.42	-	95,156.85
其他设备	69,327.00	19,506.40	-	88,833.40	552,790.00	-	641,623.40
二、累计折旧合计：	315,137.72	124,386.51	-	439,524.23	67,118.73	-	506,642.96
其中：机器设备	261,764.09	105,116.89	-	366,880.98	54,172.94	-	421,053.92
办公设备	1,822.79	8,419.70	-	10,242.49	7,339.99	-	17,582.48
其他设备	51,550.84	10,849.92	-	62,400.76	5,605.80	-	68,006.56
三、账面净值合计	862,957.84	-	-	837,739.84	-	-	1,402,419.20
其中：机器设备	822,899.74	-	-	758,533.26	-	-	751,227.99
办公设备	22,281.94	-	-	52,773.94	-	-	77,574.37
其他设备	17,776.16	-	-	26,432.64	-	-	573,616.84

(2) 于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 6 月 30 日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无用于抵押或担保的固定资产。

8、无形资产

项目	2011 年 12 月 31 日	本期 增加	本期 减少	2012 年 12 月 31 日	本期 增加	本期 减少	2013 年 6 月 30 日

一、原价合计	5,643,982.74	6,838,566.46	-	12,482,549.20	-	-	12,832,507.67
其中：软件	274,074.16	-	-	274,074.16	-	-	274,074.16
专利权	-	2,860,198.00	-	2,860,198.00	-	-	2,860,198.00
非专利技术	-	535,012.96	-	535,012.96	-	-	535,012.96
知识产权	5,369,908.58	3,275,834.13	-	8,645,742.71	-	-	8,645,742.71
其他无形资产	-	167,521.37	-	167,521.37	350,058.47	-	517,479.84
二、累计摊销额合计	1,466,202.75	1,250,664.39	-	2,716,867.14	1,233,647.66	-	3,950,514.80
其中：软件	52,993.55	54,814.83	-	107,808.38	27,407.46	-	135,215.84
专利权	-	47,669.97	-	47,669.97	286,019.80	-	333,689.77
非专利技术	-	8,916.88	-	8,916.88	53,501.30	-	62,418.18
知识产权	1,413,209.20	1,128,578.95	-	2,541,788.15	828,391.50	-	3,370,179.65
其他无形资产	-	10,683.76	-	10,683.76	38,327.60	-	49,011.36
三、减值准备金额合计	-	140,519.90	-	140,519.90	-	-	140,519.90
其中：软件	-	-	-	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-	-	-	-
知识产权	-	140,519.90	-	140,519.90	-	-	140,519.90
其他无形资产	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值合计	4,177,779.99	-	-	9,625,162.16	-	-	8,741,472.97
其中：软件	221,080.61	-	-	166,265.78	-	-	138,858.32
专利权	-	-	-	2,812,528.03	-	-	2,526,508.23
非专利技术	-	-	-	526,096.08	-	-	472,594.78
知识产权	3,956,699.38	-	-	5,963,434.66	-	-	5,135,043.16
其他无形资产	-	-	-	156,837.61	-	-	468,468.48

本公司以专利权“一种具有渐进式电流过载与饱和防止功能的开关电源”向西安市创新技术投资担保有限公司提供质押反担保。

9、开发支出

项目	2011年 12月31日	本期增加	转为无 形资产	2012年12 月31日	本期增加	转为无 形资产	2013年 6月30日
线性高压LED驱动电路专利和实用新型	-	-	-	-	1,005,452.39	-	1,005,452.39
RM3381源边反馈PFCLD驱动芯片专利布图	-	-	-	-	469,745.27	-	469,745.27
知识产权-RM6301	-	1,753,331.54	1,753,331.54	-	-	-	-
知识产权-RM6562	-	1,522,502.59	1,522,502.59	-	-	-	-
非专利技术（包含RM6204、RM327X）	-	535,012.97	535,012.97	-	-	-	-
专利技术（发明专利3项和实用新型专利3项）	-	2,860,198.00	2,860,198.00	-	-	-	-
合计	-	6,671,045.09	6,671,045.09	-	1,475,197.66	-	1,475,197.66

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细情况

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
递延所得税资产	24,209.42	2,809.90	831.08

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产减值准备	161,396.08	18,732.68	5,540.50

11、资产减值准备

项目	2011年 12月31日	本期增加	本期减少		2012年 12月31日	本期增加	本期减少		2013年 6月30日
			转回	转销			转回	转销	
坏账准备	5,540.50	1,959.50	-	550.00	6,950.00	1,926.00	-	-	8,876.00
存货跌价准备	-	11,782.68	-	-	11,782.68	-	-	-	11,782.68
无形资产减值准备	-	140,519.90	-	-	140,519.90	-	-	-	140,519.90
合计	5,540.50	154,262.08	-	550.00	159,252.58	1,926.00	-	-	161,178.58

(五) 主要负债情况

1、短期借款

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
担保借款	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00

(1) 2013年6月30日短期借款系根据本公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订的流动资金借款合同获取的公司经营周转资金借款，由西安市创新技术投资担保有限公司提供贷款全额担保，同时，本公司以专利权“一种具有渐进式电流过载与饱和防止功能的开关电源”向西安市创新技术投资担保有限公司提供质押反担保。

(2) 截至2013年6月30日短期借款明细表

借款银行	借款性质	借款用途	借款金额	借款期间
上海浦东发展银行西安高新开发区支行	担保借款	补充流动资金	3,000,000.00	2012年9月28日至 2013年9月26日

上海浦东发展银行西安高新开发区支行	担保借款	补充流动资金	2,000,000.00	2012年9月28日至 2013年8月26日
-------------------	------	--------	--------------	---------------------------

2、应付账款

(1) 于2011年12月31日、2012年12月31日及2013年6月30日应付账款按照账龄分析如下：

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,040,396.65	100	2,785,646.38	100	5,422,205.11	97.82
1至2年	-	-	-	-	120,915.10	2.18
合计	4,040,396.65	100	2,785,646.38	100	5,543,120.21	100

(2) 截至2013年6月30日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	无锡颐鼎科技公司	1,083,954.19	26.83	货款	1年以内
2	上海贝岭微电子制造有限公司	1,082,954.00	26.80	货款	1年以内
3	西安艾铂电子科技有限公司	1,047,535.37	25.93	货款	1年以内
4	深圳市远诚电子有限公司	302,825.56	7.49	货款	1年以内
5	深圳市华宇半导体有限公司	229,701.07	5.69	货款	1年以内
合计		3,746,970.19	92.74		

(3) 截至2012年12月31日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	上海贝岭微电子制造有限公司	1,313,454.00	47.15	货款	1年以内
2	西安艾铂电子科技有限公司	1,242,959.01	44.62	货款	1年以内
3	深圳市华宇半导体有限公司	66,111.84	2.37	货款	1年以内
4	无锡颐鼎科技公司	51,440.97	1.85	货款	1年以内
5	深圳市源达力电子科技有限公司	48,518.94	1.74	货款	1年以内
合计		2,722,484.76	97.73		

(4) 截至2011年12月31日应付账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
----	------	-------	----------	------	----

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	西安艾铂电子科技有限公司	2,835,760.93	51.16	货款	1年以内
2	无锡颐鼎科技公司	1,408,595.54	25.41	货款	1年以内
3	上海贝岭微电子制造有限公司	503,457.04	9.08	货款	1年以内
4	深圳市华宇半导体有限公司	255,525.26	4.61	货款	1年以内
5	昱品国际贸易(上海)公司	185,656.91	3.35	货款	1年以内
合计		5,188,995.68	93.61		

(5) 截至2013年6月30日, 应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项及应付其他关联方款项。

3、预收款项

(1) 于2011年12月31日、2012年12月31日及2013年6月30日预收账款按照账龄分析如下:

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	330,004.60	100	6,000.00	100	36,150.00	100

(2) 截至2013年6月30日预收账款余额前三名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	厦门新一电子有限公司	150,000.00	45.45	货款	1年以内
2	常州雷德半导体科技有限公司	100,000.00	30.30	货款	1年以内
3	普诚科技(深圳)有限公司	80,004.60	24.25	货款	1年以内
合计		330,004.60	100		

(3) 截至2012年12月31日预收账款余额前一名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	深圳市众翔辉电子科技有限公司	6,000.00	100	货款	1年以内

(4) 截至2011年12月31日预收账款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
----	------	-------	----------	------	----

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
1	深圳市深谷微电子科技有限公司	14,600.00	40.39	货款	1年以内
2	深圳市佳林卓电子有限公司	10,500.00	29.05	货款	1年以内
3	深圳市惠博升科技有限公司	5,250.00	14.52	货款	1年以内
4	安徽振华光电科技有限公司	4,400.00	12.17	货款	1年以内
5	深圳市红炬科技有限公司	1,400.00	3.87	货款	1年以内
合计		36,150.00	100		

(5) 截至 2013 年 6 月 30 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项及预收其他关联方款项。

4、应交税费

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	27,556.31	1,602.79	-152,070.76
城市维护建设税	1,928.94	112.2	-
教育费附加	1377.82	80.14	-
个人所得税	8,155.92	7,669.39	1,707.51
企业所得税	77,441.70	193,871.34	1,022,832.78
其他税费	3,086.25	1,916.87	3,288.42
合计	119,546.94	205,252.73	875,757.95

5、其他应付款

(1) 截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日其他应付款按账龄分析如下：

账龄结构	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,417,500.00	100	1,100,000.00	100	6,313,135.73	100

公司其他应付款系公司为了日常经营向第三方个人借款，所借款项全部用于补充日常流动资金。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日其他应付款余额前二名的情况

序号	单位名称	金额（元）	占总额比例（%）	款项性质	账龄
----	------	-------	----------	------	----

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	刘萍	1,545,000.00	63.91	个人借款	一年以内
2	王慧	872,500.00	36.09	个人借款	一年以内
合计		2,417,500.00	100		

2013年3月,公司与王慧个人签订借款协议,因公司业务发展需要,向王慧借款850,000.00元,期限为2013年3月18日至2014年3月17日,其中计提利息22,500.00元,为期1年,年利率为18.00%。

2013年4月,公司与刘萍个人签订借款协议,因公司业务发展需要,向刘萍借款1,500,000.00元,期限为2013年4月23日至2013年10月22日,其中计提利息45,000.00元,为期6个月,月利率为1.50%。

(3) 截至2012年12月31日其他应付款余额前二名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	杨素英	800,000.00	72.73	个人借款	一年以内
2	赵蒙	300,000.00	27.28	个人借款	一年以内
合计		1,100,000.00	100		

2012年8月,公司与杨素英个人签订借款协议,因公司业务发展需要,向杨素英借款800,000.00元,期限为2012年8月31日至2013年8月30日,为期1年,年利率为0.00%。

2012年3月,公司与赵蒙个人签订借款协议,因公司业务发展需要,向赵蒙借款300,000.00元,期限为2012年3月19日至2013年3月18日,为期1年,年利率为0.00%。

(4) 截至2011年12月31日其他应付款余额前五名的情况

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
1	西安正丰复合材料有限公司	1,567,500.00	24.83	个人借款	一年以内
2	刘亚如	2,075,000.00	32.87	个人借款	一年以内
3	王慧	1,254,000.00	19.86	个人借款	一年以内
4	陈楷华	834,583.33	13.22	个人借款	一年以内
5	腾飞	577,450.00	9.15	个人借款	一年以内

序号	单位名称	金额(元)	占总额比例(%)	款项性质	账龄
	合计	6,308,533.33	99.93		

2011年9月,公司与西安正丰复合材料有限公司签订借款协议,因公司业务发展需要,向西安正丰复合材料有限公司借款1,500,000.00元,期限为2011年9月28日至2012年9月28日,其中计提利息67,500.00元,为期1年,年利率为18.00%。

2011年9月,公司与刘亚如个人签订借款协议,因公司业务发展需要,向刘亚如借款2,000,000.00元,期限为2011年9月22日至2012年9月19日,其中计提利息75,000.00元,为期1年,年利率为15.00%。

2011年9月,公司与王慧个人签订借款协议,因公司业务发展需要,向西王慧借款1,200,000.00元,期限为2011年9月28日至2012年9月28日,其中计提利息54,000.00元,为期1年,年利率为18.00%。

2011年3月,公司与陈楷华个人签订借款协议,因公司业务发展需要,向陈楷华借款750,000.00元,期限为2011年3月26日至2012年4月15日,其中计提利息84,583.33元,为期1年零19天,年利率为15.00%。

2011年10月,公司与腾飞个人签订借款协议,因公司业务发展需要,向腾飞借款577,450.00元,期限为2011年10月9日至2012年4月8日,为期6个月,年利率为0.00%。

(5) 截至2013年6月30日,期末余额中其他应付无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项及应付其他关联方款项。

(六) 股东权益情况

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
股本	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
资本公积	37,206.08	37,206.08	37,206.08
盈余公积	938,035.09	938,035.09	699,621.36
未分配利润	8,963,309.70	7,933,329.17	5,787,605.60
合计	21,938,550.87	20,908,570.34	18,524,433.04

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一章公司基本情况”之“四、公司成立以来股本的形成及其变化情况”的内容。

四、关联交易

(一) 公司的关联方

1、存在控制的关联方

名称	与公司关系	备注
余远强	本公司控股股东	董事长

2、不存在控制的关联方

名称	与公司关系	备注
张炜东	本公司股东	董事
杨波	本公司股东	董事
胡晓博	本公司股东	董事、副总经理
陈彬	本公司股东	财务总监、董事会秘书
冯晓波	本公司股东	监事
杨世红	本公司股东	董事
陈楷华	本公司股东	监事会主席
北京行健势坤投资咨询有限公司	本公司控股股东投资的公司	

(二) 关联交易

1、关联方交易

除本说明书第三章“公司治理”之第七节“公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况”披露的外，公司无其他关联方交易。

2、关联方往来余额

其他应付款：

名称	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
陈楷华			750,000.00-

除此之外，于2013年6月30日、2012年12月31日及2011年12月31日，公司不存在其他关联方余额。

五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

截至本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的期后事项。

(二) 或有事项

截至本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

截至本公开说明书签署之日起，公司无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

2011年5月公司为进行股份制改造，委托西安正衡资产评估有限责任公司对公司资产进行了评估，评估基准日：2011年4月30日。本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法。

资产基础法评估结果：公司总资产账面价值为1,919.80万元，总负债账面价值为716.08万元，净资产账面价值为1,203.72万元；总资产评估值为2,093.16万元，增值额为173.36万元，增值率为9.03%；总负债评估值为716.08万元，净资产评估值为1,377.08万元，增值额为173.36万元，增值率为14.40%。

收益法评估结果：净资产评估值为2,451.27万元，净资产评估增值1,247.55万元，增值率为103.64%。

考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。

七、股利分配

(一) 报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金10%；

- (3) 提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；
- (4) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

(1) 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

(2) 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%；

(3) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

(4) 公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，公司可以进行中期现金分红，存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 实际股利分配情况

公司最近两年一期没有进行股利分配。

(三) 公开转让后的股利分配政策

公司公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况

于报告期内公司无纳入合并报表的子公司。

九、影响公司持续经营的风险因素

1、市场风险

公司主营业务为数字模拟混合集成电路产品的设计、开发和销售。集成电路产业是信息产业的核心，属于国家战略性基础产业，集成电路产业的波动与

全球经济环境密切相关，受全球集成电路产品市场需求和集成电路行业波动影响较大。公司 2012 年销售收入下降一定程度上也是全球经济环境影响，所以公司面临一定的市场风险。

应对公司面临的市场风险，主要有两方面（1）从研发方面，为了最大限度降低公司受市场风险的影响，公司将加大技术研发和新产品开发力度，提高公司产品的附加值；公司将及时研究集成电路行业的发展动向和用户的潜在需求，建立快速有效的市场反应机制，积极应对市场风险。（2）从市场销售方面，公司将现有客户所处领域挖掘更深入，使高端客户低端客户搭配更合理；同时公司将更大程度的拓宽应用领域，建立更成熟的销售网络，形成更广泛的客户基础，与下游的客户建立长期的战略合作关系。

2、委托加工风险

国内 IC 设计企业大部分采取委托加工的经营模式，即仅从事 IC 产品的设计、销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。无生产线经营模式具有轻便灵活的特点，公司选择此模式没有沉重的生产线运营负担，也无需负担芯片生产线昂贵的维护成本，可以专注于技术创新；通过开发业界领先的技术，依靠晶圆代工厂将技术转化为芯片产品，可以专注于自己的核心业务，充分发挥核心竞争力。但随之而来的风险是晶圆代工、封装、测试等环节需要依赖供应商的工艺平台，在产能、交货期限以及不可抗力因素方面，公司存在一定程度的委托加工风险。

今后公司产品在不同的代工环节将选择多家供应商合作，与其签订长期的合作协议，避免某家供应商的工艺平台不能正常生产时对公司销售造成不利影响。

3、核心技术人员流失或短缺风险

公司作为 IC 设计企业，核心竞争力主要体现自主研发能力和稳定的研发团队上。公司的发展在很大程度上取决于产品的研发速度，因此公司对高端技术人才有较大需求。随着国内对集成电路设计人员需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并保留人才，对公司未来的发展至关重要，

所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。

核心技术人员一般任公司高管或部门主管，持有公司股权，在工作中有较大的主动性；同时将核心技术人员的奖金与研发成果相关联，充分提高其积极性。随着公司销售收入的快速增长、公司规模不断扩大，公司将适时对更多的加入公司的核心技术人员再进行股权或期权激励，使其自身利益与公司利益高度一致，更好地稳定公司核心技术人员团队。

4、研发风险

集成电路行业的主要特点之一是研发周期长，包括了解市场需求、可行性研究、产品研发、样品测试、投入量产等多个阶段，通常需要半年到一年的时间。在此期间内，如果市场需求发生变化，可能导致公司研发出的产品与当初市场预期不一致，公司面临一定的研发风险。

公司经过多年研发积累了大量的经过验证的功能模块和单元，公司将以这些功能模块为基础进行新产品的研发，以加快公司新产品的研发速度，使公司产品能更好的适应市场需求，降低因市场变动引发的风险。

5、税收风险

2009年12月，公司首次获得高新技术企业认定，有效期为三年，按照相关规定自2010年1月至2012年12月减按15%税率征收企业所得税。2012年高新技术企业复审通过，有效期三年，公司可自2013年1月至2015年12月减按15%税率征收企业所得税。由于高新技术企业需要定期复审，若公司不能通过高新技术企业认证复审或国家取消相关税收优惠政策，公司将执行25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

公司按时完成复审，争取继续享受高新技术企业的税收优惠。同时，公司加大对新产品的研发和公司产品的销售网络布局，增加公司营业收入和利润。

第五章 有关声明

申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《陕西亚成微电子股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

全体董事签字：

余远强：余远强 张炜东：张炜东 胡晓博：胡晓博

杨波：杨波 杨世红：杨世红

全体监事签字：

陈楷华：陈楷华 冯晓波：冯晓波 张江永：张江永

全体高级管理人员签字：

余远强：余远强 胡晓博：胡晓博 陈彬：陈彬

陕西亚成微电子股份有限公司

2013年10月22日

主办券商声明

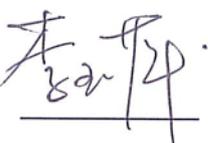
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文, 为《陕西亚成微电子股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

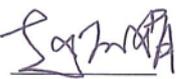
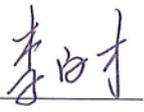
公司法定代表人:

宫少林: 

项目负责人:

李玉萍: 

项目小组成员:

赵丽娟:  李白才:  廖凌雁: 

尹 为: 

招商证券股份有限公司(公章)

2013年10月23日



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公开转让说明书引用的法律意见书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《陕西亚成微电子股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

经办律师（签字）：

杨琦：杨琦 陈凯：陈凯

机构负责人（签字）：

方燕：方燕

北京金诚同达律师事务所西安分所



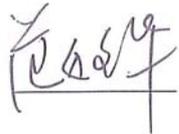
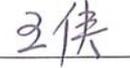
2013年10月22日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公开转让说明书引用的审计报告内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《陕西亚成微电子股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

签字注册会计师（签字）：

范敏华： 王 侠：

法定代表人（签字）：

吕桦：

希格玛会计师事务所有限公司

2013年10月22日

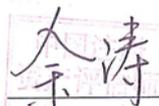


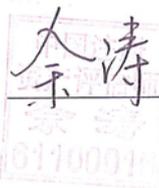
评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告书无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对公开转让说明书引用的资产评估报告书内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

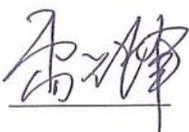
(本页无正文，为《陕西亚成微电子股份有限公司公开转让说明书》的签字页。)

签字注册资产评估师（签字）：

余涛： 靳晓亮：



法定代表人（签字）：

雷华锋：

正衡资产评估有限责任公司



2013年10月22日

第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件

(正文完)